

股票简称：胜宏科技

股票代码：300476



胜宏科技（惠州）股份有限公司

Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.,Ltd.

（注册地址：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园）

2021年度向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿）

保荐机构（主承销商）



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

二〇二一年八月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

发行人特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”。

一、募集资金投资项目不能实现预期收益的风险

本次募投项目在扩充现有优势产品多层板、HDI 产能的基础上，对公司现有产品结构进行升级，产品平均设计层数/阶数提高，工艺水平更加先进，技术难度更高，且新增 IC 封装基板产品。公司 IC 封装基板处于研发阶段，目前暂未量产，该产品在所需基材类型、生产工艺、具体应用场景等方面，与公司现有产品存在一定差异，技术壁垒和客户认证壁垒较高。发行人在 PCB 行业已有深厚积累，拥有充足的客户、人才和技术储备，但若新产品 IC 封装基板的研发量产或销售推广进度不达预期，或者项目建设受到市场需求变动、建设进度、研发成果产业化效率等因素的影响，将导致募集资金投资项目不能实现预期收益的风险。

二、新增产能无法及时消化的风险

发行人现有生产基地 HDI 二期项目即将进入试产阶段，达产后，发行人现有生产基地的产能预计可达 860 万 m²/年。本次募投项目拟新建高端多层板产能 145 万 m²/年、高阶 HDI 40 万 m²/年、IC 封装基板 14 万 m²/年，建成投产后，公司整体产能将出现较大幅度提高，同时固定资产折旧增加较多。本次募投项目系对公司现有产品结构的升级，在客户群体等方面与现有业务存在共通性；但若宏观环境发生不利变化，或者公司市场开拓进展不利，新增产能将存在无法及时消化的风险，进而影响本次募集资金投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。

三、募投项目新增 IC 封装基板等产品的风险

本次募投项目拟新增 IC 封装基板产品，并扩充高阶 HDI 产品产能。公司 IC 封装基板处于研发阶段，目前暂未量产，该产品在所需基材类型、生产工艺等方面，与公司现有产品存在一定差异。公司高阶 HDI 产品已具备量产能力，但目前在公司全部 HDI 产品中占比仍较少。若公司 IC 封装基板的研发量产不成功，高阶 HDI 的销售推广不达预期，可能影响募投项目的顺利实施或效益实现。

四、原材料供应紧张及价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为覆铜板、半固化片、铜球、铜箔，原材料成本占产品成本比重较高，报告期各期，直接材料占主营业务成本比重分别为 61.28%、61.26%、63.35%和 64.66%。原材料成本是公司产品定价的重要影响因素之一，原材料大幅涨价的情形下，公司会相应提高产品售价，但向下游的传导存在一定滞后。2020 年下半年起，国际铜价开始上涨，叠加下游市场需求复苏等因素的影响，公司主要原材料采购价格波动幅度较大，对公司 2021 年一季度的主营业务毛利率形成负面影响。

2021 年一季度，发行人的覆铜板、半固化片、铜球、铜箔四种主要原材料的采购单价分别上涨 23.88%、16.74%、25.10%和 18.03%，主营业务毛利率为 17.92%，较 2019 年、2020 年的 22.43%和 19.97%下降幅度较大。若未来原材料持续供应紧张、价格持续大幅上涨，而公司不能通过提高产品价格向下游客户转嫁原材料涨价成本，或通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，可能出现原材料供应不足或盈利能力下降等情形，将对公司的经营成果产生不利影响。

五、即期回报被摊薄的风险

本次发行募集资金到位后，公司净资产规模和股本数量将有所提高，若募资金使用效益短期内难以全部显现，或短期内公司利润增长幅度将小于净资产和股本数量的增长幅度，公司的每股收益存在短期内被摊薄的风险。

六、债务偿还风险

目前公司长期资产支出较多，银行借款规模较大，资产负债率处于较高水平。截至 2021 年 3 月末，公司短期借款金额为 165,711.40 万元，一年内到期的长期借款金额为 4,178.07 万元，长期借款金额为 94,821.76 万元。如果国家货币政策发生较大变动，或公司未来流动资金不足，未能如期偿还银行借款，可能给公司正常的生产经营造成不利影响。

七、贸易摩擦风险

报告期各期，公司境外收入分别为 154,255.99 万元、208,411.94 万元、324,082.85 万元和 84,561.97 万元，境外收入占比分别为 49.13%、57.01%、60.85%和 57.09%，占比较高。

近年来，国际贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护手段，降低或限制我国

产品的进出口。2018 年以来，美国对进口产自中国的包括 PCB 产品在内的多项电子产品加征关税，同时我国政府采取反制措施，对产自美国的部分进口商品加征关税，公司对美国客户的销售受到一定影响。报告期内，公司出口美国产品收入占主营业务收入的比例分别为 0.03%、0.10%、0.02 和 0.00%，占比相对较小，因此贸易摩擦对公司境外销售及募投项目实施的影响较小。

若国际贸易摩擦加剧，可能会对全球经济及产业链竞争格局带来较大冲击，进而对中国整个 PCB 行业带来影响，对公司境外销售及经营业绩产生不利影响。

目 录

公司声明	2
重大事项提示	3
目 录	6
释 义	8
一、普通术语	8
二、专业术语	9
第一节 发行人基本情况.....	11
一、股权结构、控股股东及实际控制人情况	11
二、所处行业的主要特点及行业竞争情况	13
三、主要业务模式、产品或服务的主要内容	24
四、现有业务发展安排及未来发展战略	31
五、财务性投资情况	32
六、未决诉讼、仲裁等事项	32
七、行政处罚情况	32
第二节 本次证券发行概要.....	33
一、本次发行的背景和目的	33
二、发行对象及其与发行人的关系	35
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期	36
四、募集资金投向	37
五、本次发行是否构成关联交易	37
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化	37
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	38
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.....	39
一、本次募集资金使用计划	39
二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析	39
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	53
四、募集资金使用可行性分析结论	53
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	54
一、本次发行后上市公司的业务及资产的变动或整合计划	54
二、本次发行后公司控制权结构的变化	54
三、发行后公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况	54
四、发行后公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的	

情况.....	55
第五节 历次募集资金的使用情况.....	56
一、前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况	56
二、前次募集资金实际使用情况说明	56
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明	58
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况	58
第六节 与本次发行相关的风险因素.....	59
一、行业和经营风险	59
二、本次发行相关的风险	61
三、募集资金运用的风险	61
四、其他风险	62
第七节 有关声明	64
与本次发行相关的董事会声明及承诺事项.....	70
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明	70
二、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报所采取的措施	70

释 义

在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

一、普通术语

发行人、公司、股份公司、胜宏科技	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司
胜宏有限	指	胜宏科技（惠州）有限公司，系发行人前身
募集说明书	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票募集说明书
本次发行	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司本次拟向特定对象发行方式发行人民币普通股的行为
深圳胜华	指	深圳市胜华欣业投资有限公司，系发行人控股股东
香港胜宏	指	胜宏科技集团（香港）有限公司，系发行人第二大股东
胜宏电子	指	深圳市胜宏电子有限公司，系发行人全资子公司
胜华电子	指	胜华电子（惠阳）有限公司，系发行人全资子公司
胜宏研究院	指	惠州市胜宏科技研究院有限公司，系发行人全资子公司
宏兴国际	指	HONG XING INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED，系发行人全资子公司
日本宏兴	指	宏兴国际株式会社，系发行人全资子公司
美国宏兴	指	VGT PCB INC，系发行人全资子公司
南通胜宏	指	南通胜宏科技有限公司，系发行人全资子公司
惠州宏大	指	惠州市宏大投资发展有限公司
龙台酒业	指	甘肃龙台酒业有限公司
陇上旅游	指	陇上江南旅游开发有限公司
兰创投资	指	前海兰创投资管理有限责任公司
陈氏庄园	指	文县陈氏庄园酒店管理有限公司
博达兴	指	惠州市博达兴实业有限公司
公司章程	指	截至本募集说明书签署之日有效的《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
保荐机构、主承销商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
发行人会计师、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、信达	指	广东信达律师事务所
《管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《审核规则》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规

		则》
报告期、最近三年一期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-3 月

二、专业术语

PCB、印制 线路板	指	“Printed Circuit Board”的缩写，即采用电子印刷术制作的、在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板。印制电路板是电子元器件的支撑体和电气连接的载体，又可称为“印制线路板”、“印刷线路板”。
单面板	指	仅在绝缘基板的一侧表面上形成导体图形，导线只出现在其中一面的 PCB。
双面板	指	在基板两面形成导体图案的 PCB，两面间一般有适当的导孔相连。
多层板	指	具有更多层导电图形的 PCB，生产中需采用定位技术将 PCB、绝缘介质交替粘结并根据设计要求通过适当的导孔互联。
HDI	指	“High Density Interconnection”的缩写，即高密度互连积层板，一种使用微盲孔导通技术且布线密度高于常规 PCB 的印制电路板。
高阶 HDI	指	在 L1-L3 及以上层次或 Ln-Ln-2 以上层次以上微盲孔导通技术且布线密度高于常规 PCB 的印制电路板。
汽车板	指	应用在汽车发动机管理系统、汽车仪表系统、汽车照明系统、车身电子系统等汽车部件的印制电路板。
普通板	指	泛指使用普通 FR-4 环氧玻纤布覆铜板生产的印制电路板。
覆铜板	指	由铜箔、树脂、补强材料及其它功能补强添加物组成的 PCB 加工基材，可分为刚性材料（纸基、玻纤基、复合基、陶瓷和金属基等特殊基）和柔性材料两类。
半固化片	指	一种用于制作多层板的、主要由树脂和增强材料组成的材料。其中增强材料又分为玻纤布、纸基、复合材料等几种类型，目前制作多层印制板所使用的半固化片大多采用玻纤布做增强材料。
盲埋孔	指	将 PCB 任意相邻层以电镀孔连接的称为盲孔，将 PCB 内部任意电路层的连接但未导通至外层的称为埋孔。
5G	指	第五代移动通讯技术，具有高数据速率、延迟低、允许大规模设备连接的特性，使得智能手机、可穿戴设备、AR/VR 设备、多功能笔记本电脑、平板电脑、智能音箱、物联网硬件等智能终端能够互联。
AR	指	“Augmented Reality”的缩写，即增强现实，是一种促使真实世界信息和虚拟世界信息内容之间综合在一起技术内容和硬件系统。
VR	指	“Virtual Reality”的缩写，即虚拟现实，是一种可以创建和体验虚拟世界的仿真系统和硬件系统。
物联网	指	是互联网、传统电信网等的咨询承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。
RoHS	指	欧盟发布的《关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质指令》。
Prismark	指	“Prismark Partners LLC”的缩写，是印制线路板及其相关领域知名的市场分析机构。
CPCA	指	“China Printed Circuit Association”的缩写，即中国电子电路行业协会，是中国工业和信息化部业务主管、民政部批准成立的国家一级行业协会。

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由

四舍五入造成的。

第一节 发行人基本情况

一、股权结构、控股股东及实际控制人情况

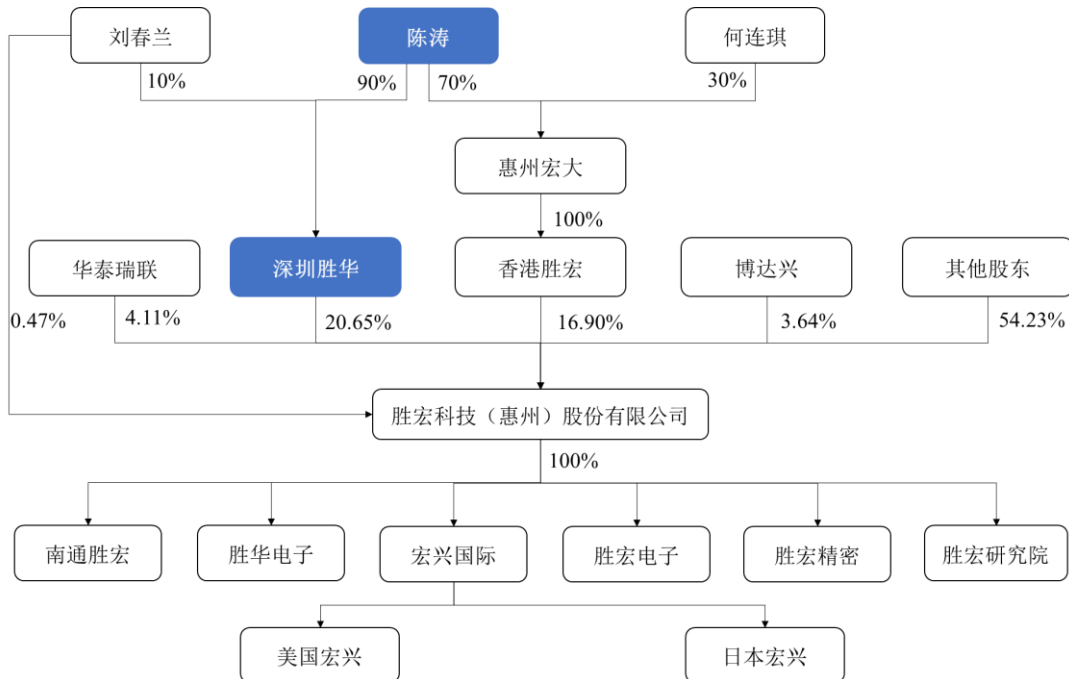
（一）发行人基本情况

公司名称	胜宏科技（惠州）股份有限公司
英文名称	Victory Giant Technology (HuiZhou) Co.,Ltd.
成立日期	2006年7月28日（有限责任公司成立）
	2012年2月27日（股份有限公司设立）
股本	777,561,455 元
法定代表人	陈涛
注册地址	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
办公地址	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
股票简称	胜宏科技
股票代码	300476
股票上市地	深圳证券交易所
董事会秘书	赵启祥
联系电话	0752-3761918
传真号码	0752-3761928
电子信箱	zqb@shpcb.com
经营范围	新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发和生产和销售。产品国内外销售。

（二）公司股权结构

1、股权结构图

截至 2021 年 6 月 30 日，公司股权结构图如下：



2、公司前十名股东持股情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司的前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股 比例
1	深圳市胜华欣业投资有限公司	160,566,476	20.65%
2	胜宏科技集团(香港)有限公司	131,432,001	16.90%
3	华泰瑞联基金管理有限公司-南京华泰瑞联并购基金二号(有限合伙)	31,946,896	4.11%
4	惠州市博达兴实业有限公司	28,311,973	3.64%
5	基本养老保险基金一二零五组合	23,250,000	2.99%
6	交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	17,600,000	2.26%
7	中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金	15,005,511	1.93%
8	易方达基金管理有限公司-社保基金 17041 组合	14,964,978	1.92%
9	中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金	13,000,000	1.67%
10	全国社保基金五零二组合	10,074,261	1.30%
	合计	446,152,096	57.37%

(三) 控股股东及实际控制人

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。截至 2021 年 8 月 17 日，公司控股股东深圳胜华持有公司 20.65% 的股份，香港胜宏持有公司 16.90% 股权，实际控制人陈涛持有深圳胜华 90% 的股权并间接持有香港胜宏 70% 的股权，合计控制公司 37.55% 的表决权，为公司实际控制人。

本次向特定对象发行股票数量不超过 233,268,436 股，以上限 233,268,436 股计算，本次发行完成后，控股股东深圳胜华持有公司 15.88% 的股权，陈涛控制公司 28.88% 的表决权，本次向特定对象发行股票不会导致公司实际控制人发生变更。

1、控股股东

项目	基本情况
公司名称	深圳市胜华欣业投资有限公司
成立时间	2001 年 9 月 3 日
注册资本	50 万元
法定代表人	陈涛
住所	深圳市南山区南山大道新海大厦 15D
经营范围	项目投资；国内贸易。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）

深圳胜华股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
------	---------	------

陈涛	45.00	90.00%
刘春兰	5.00	10.00%
合计	50.00	100.00%

截至 2021 年 8 月 17 日，深圳胜华持有公司 160,566,476 股股份，其中被质押的数量为 17,000,000 股，占总股本的比例为 2.19%，质押情况具体如下：

股东名称	质押方	质押股数 (万股)	融资金额 (万元)	质押初始交易日
深圳胜华	中信证券股份有限公司	1,700.00	15,000.00	2021/4/6

2、实际控制人

陈涛先生，出生于 1972 年 4 月，中国国籍，EMBA，高级工程师，无境外永久居留权；曾任新疆兵团武警指挥部三支队机关事务长、新疆喀什市二轻局服务公司业务经理、广东惠州统将电子有限公司董事长助理、胜宏有限董事长，现任公司董事长兼总经理、胜华电子董事长兼总经理、宏兴国际董事、香港胜宏董事、惠州宏大执行董事、陇上旅游执行董事、龙台酒业执行董事、深圳胜华执行董事、胜宏电子执行董事、胜宏研究院执行董事兼总经理、胜宏精密执行董事、南通胜宏执行董事。

二、所处行业的主要特点及行业竞争情况

发行人所属行业为印制电路板制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），发行人主营业务归属于“电子元件制造”中的“印制电路板制造”，行业代码为 C3972。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人主营业务归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为 C39。

根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1. 新一代信息技术产业之 1.2 电子核心产业之 1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

（一）行业发展情况

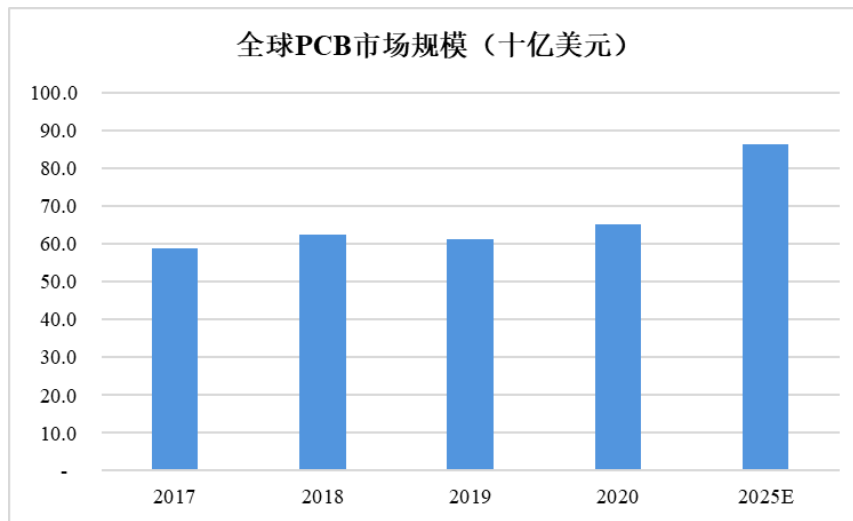
1、全球 PCB 行业发展现状

（1）市场规模

印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，以组成一个具有特定功能的模块或成品，在整个电子产品中具有不可替代性，有“电子产品之母”之称。印制线路板广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺电子元器件。

随着云技术、5G、大数据、人工智能、工业 4.0、物联网等技术日臻发展，PCB 行业作为电子产业链的基础力量产值规模稳健增长。

根据 Prsimark 数据，2020 年全球 PCB 市场规模达到约 650 亿美金，同比增长超过 6%；其中，IC 封装基板的产值规模同比增长达到 25.2%，HDI 技术的应用范围逐渐拓展，同比增长达到 10.5%。Prismark 的最新预测数据显示，2021 年全球 PCB 市场规模将同比增长 14%，达到 740 亿美金，增长动力来自通信、消费电子、电动汽车等下游各个领域的市场需求扩大，以及技术升级和供应链恢复。



数据来源：Prismark

（2）产值分布

在 2000 年以前，全球 PCB 产值 70% 以上分布在美洲（主要是北美）、欧洲及日本等地区。进入 21 世纪以来，PCB 产业重心不断向亚洲地区转移。目前亚洲地区 PCB 产值已接近全球的 90%，尤以中国和东南亚地区增长最快。自 2006 年开始，中国超越日本成为全球第一大 PCB 生产国，PCB 的产量和产值均居世界第一，行业的最大生产国，占全球 PCB 行业总产值的比例已由 2008 年的 31.18% 上升至 2020 年的 53.75%。

地区和国家	2008 年		2020 年	
	产值（亿美元）	比例	产值（亿美元）	比例
美洲	44.84	9.30%	28.98	4.44%
欧洲	32.08	6.65%	16.13	2.47%
日本	101.86	21.12%	57.71	8.85%
中国大陆	150.37	31.18%	350.54	53.75%
其他地区	153.15	31.75%	198.83	30.49%
总计	482.30	100.00%	652.19	100.00%

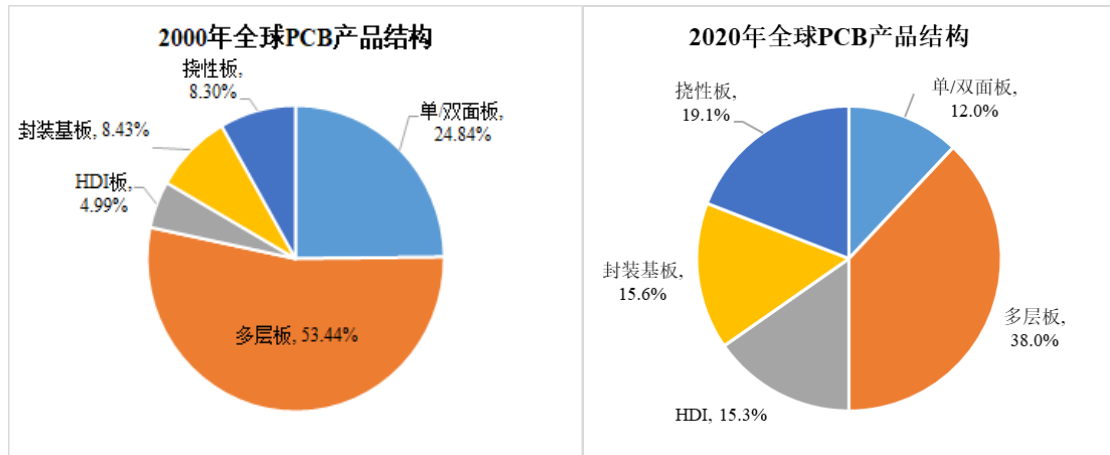
数据来源：Prismark

上表可见，美洲、欧洲、日本的 PCB 产值金额和占比均呈现较大幅度下降，中国大陆和亚洲其他地区（如韩国、中国台湾和东南亚）等地 PCB 行业发展较快。

（3）产品结构

随着世界电子电路行业技术迅速发展，元器件的片式化和集成化应用日益广泛。电子产品对 PCB 板的高密度化要求更加突出；多层板、HDI 板、IC 封装基板等高端 PCB 产品的市场地位提升。根据 PrismaMark 的数据，2020 年，多层板、HDI 板和 IC 封装基板三种印制线路板的合计占比达到 68.9%。

自 2000 年至 2020 年，HDI 板的产值占比由 4.99% 增长至 15.3%，挠性板的产值占比由 8.30% 增长至 19.1%，封装基板的产值占比由 8.43% 增长至 15.6%，而单/双面板和多层板的占比有所下降。

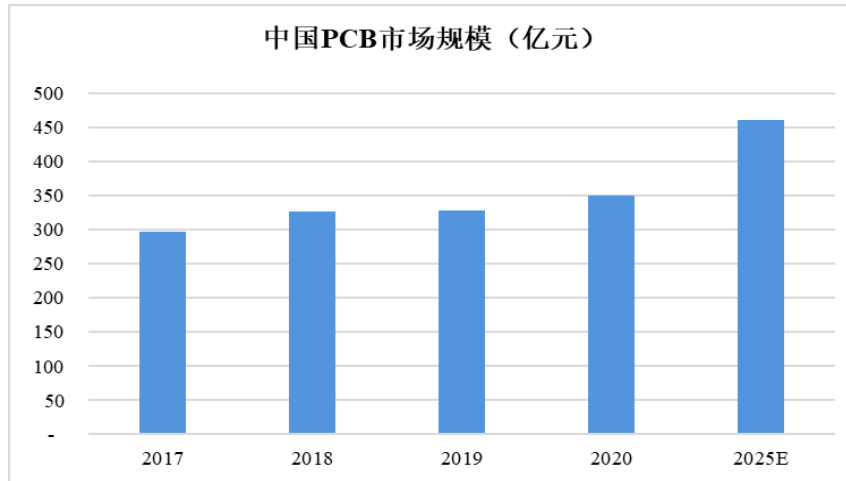


数据来源：PrismaMark

2、中国 PCB 行业发展现状

（1）产值规模

受益于 PCB 行业产能不断向我国转移，加之通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等下游领域强劲需求增长的刺激，近两年我国 PCB 行业增速明显高于全球 PCB 行业增速。根据 PrismaMark 统计，2020 年中国 PCB 行业产值约 350 亿美元，同比增长 6.4%，全球市场占比进一步扩大至 53.75%。随着 5G、大数据、云盘算、人工智能、物联网等行业快速生长，以及工业配套、成本等优势，中国 PCB 行业的市场占比仍将进一步提升。



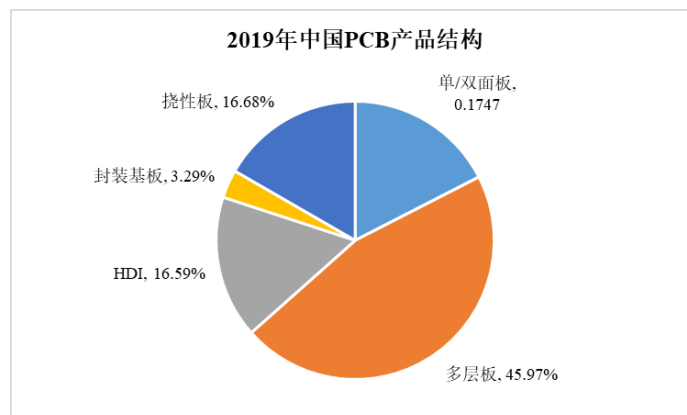
数据来源：Prismark

（2）产值分布

据 N.T.InformationLtd 统计，全球 PCB 厂商约 2800 家；在中国，PCB 的企业数量约为 1500 家，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，该等地区具备较强的经济优势、区位优势及人才优势。然而，近年来受劳动力成本不断上涨影响，部分 PCB 企业为缓解劳动力成本等上涨带来经营压力，逐步将生产基地转移至内陆地区，如江西、湖南、安徽、湖北等地区。由于中国内需持续增长及产业集聚效应，诸多外资 PCB 企业也在中国大陆投资建厂。

（3）产品结构

根据 Prismark 统计，2019 年我国刚性板的规模最大，其中多层板占比 45.97%；其次是柔性板，占比达 16.68%；HDI 板占比为 16.59%。与先进的 PCB 制造国如日本相比，目前我国的高端印制电路板占比仍较低，尤其是封装基板及刚挠结合板（软硬结合板）方面。



数据来源：Prismark

3、PCB 行业未来发展趋势

①高密度化、高性能化

作为电子信息产业重要的配套，PCB 行业的技术发展通常需要适应下游电子终端设备的需求。目前，电子产品主要呈现出两个明显的趋势：一是轻薄短小，二是高速高频，下游行业的应用需求对 PCB 的精细度和稳定性都提出了更高的要求，PCB 行业将向高密度化、高性能化方向发展。

高密度化是未来印制电路板技术发展的重要方向，对电路板孔径大小、布线宽度、层数高低等方面提出了更高的要求；高密度互连技术（HDI）正是当今 PCB 先进技术的体现，通过精确设置盲孔、埋孔的方式来减少通孔数量，节约 PCB 可布线面积，大幅度提高元器件密度，IC 封装基板的高密度化则相较 HDI 板更为显著；高性能化主要是针对 PCB 的阻抗性和散热性等方面的性能提出要求。高层 PCB 板配线长度短、电路阻抗低，可高频高速工作且性能稳定，可承担更复杂的功能，也是增强产品的可靠性的关键。

因此，下游行业对 PCB 产品的可靠性及稳定性提出更高的要求，同时密度更高的 HDI 板、IC 封装基板在未来电子产品中的应用占比将会呈现逐渐扩大的趋势。

② 行业集中度提升

近年来，全球主要的 PCB 厂商营收规模都经历了新一轮扩张。受到下游应用领域技术要求提高、终端产品更新换代加速的影响，PCB 厂商面临更高的技术要求、资金需求，技术实力强、品牌声誉良好的大规模厂商更具竞争优势，行业集中度日益提高。据 PrismaMark 统计，全球前五大 PCB 厂商的市场份额从 2006 年的 10.80% 已增长到 2020 年的 20% 以上。

③行业生产趋于智能化

下游客户对 PCB 产品生产的精细化、个性化需求将促进 PCB 制造行业趋于智能化。智能化生产设备可以通过“机器代人”提高生产效率，提升加工精度，降低因人为误差造成的产品不良率。同时，智能化生产线基于互联网技术能够对客户订单进行快速反应，制定最优的排产方案，从而实现柔性生产来满足不同批量、不同种类的产品生产需求。

④生产重视绿色环保

在国家倡导“绿色环保”和“循环经济”的可持续性发展理念背景下，PCB 行业需要进一步加强清洁生产力度、改进生产工艺、完善产业配套来推动中国印制电路板产业的转型和升级。随着我国《土壤污染防治行动计划》（“土十条”）、《水污染防治行动计划》（“水十条”）、《中华人民共和国清洁生产促进法》等一系列环保政策的进一步落实，以及“十三五”期间环保投入的增加，PCB 行业寻求使用新型环保材料、提高环保工艺也将成为 PCB 行业发展的主要趋势。

（二）行业主要法律法规和产业政策

电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，与国民经济发展和国家安全密切相关，PCB 作为现代电子设备中的重要电子元器件之一，在电子信息产业链中发挥关键性作用，近年来，政府出台一系列政策，大力鼓励和扶持 PCB 行业发展，主要如下表所示：

发布时间	文件名称	发文单位	主要内容
2019.10	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	国家发改委	将“高密度印刷电路板、柔性电路板、高频微波印制电路板、高速通信电路板、高性能覆铜板等制造”列入鼓励类
2019.06	《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》	国家发改委、商务部	明确将“高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细线路(线宽/线距 $\leq 0.05\text{mm}$)柔性电路板”列入鼓励外商投资产业目录
2019.02	《印制电路板行业规范条件》和《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》	工信部	按照优化布局、调整结构、绿色环保、推动创新、分类指导的原则进行制定，对于 PCB 企业及项目从产能布局与项目建设、生产规模和工艺技术、智能制造、绿色制造、安全生产、社会责任等若干维度形成量化标准体系。
2018.11	《战略性新兴产业分类（2018）》	国家统计局	将“高密度互连印制电路板、特种印制电路板、柔性多层印制电路板”作为电子电路制造行业的重点产品列入战略性新兴产业分类
2017.06	《外商投资产业指导目录》（2017 年修订）	国家发改委、商务部	将“高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板”列入鼓励外商投资产业目录。
2017.01	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》	国家发展改革 委	明确将“高密度互连印制电路板、柔性多层印制电路板、特种印制电路板”作为电子核心产业列入指导目录。
2016.12	《“十三五”国家信息化规划》	国务院	对集成电路、基础元器件、基础软件等核心领域加大财税支持，优化资源配置，推进核心技术自主创新实现系统性突破。

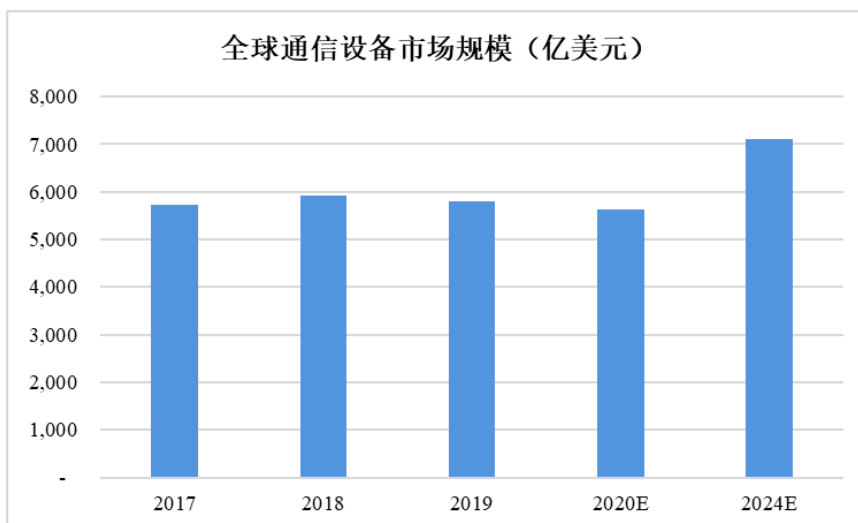
发布时间	文件名称	发文单位	主要内容
2016.11	《“十三五”战略性新兴产业发展规划》	国务院	提出“做强信息技术核心产业，顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，提升核心基础硬件供给能力”，推动“印刷电子”等领域关键技术研发和产业化。
2016.11	《鼓励进口技术和产品目录（2016年版）》	国家发改委、财政部、商务部	将“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”列入鼓励发展的重点行业。
2015.05	《中国制造 2025》	国务院	提出“强化工业基础能力，解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术。”

（三）发行人主要下游领域现状

1、通讯行业景气上涨

PCB 下游的通讯电子市场主要包括基站、路由器和交换机等产品类别。新一代通信技术 5G 的落地将通讯产业链推向新的高点，除了为产业链带来建设增量，其在技术方面的变化导致投资力度大幅高于 4G。5G 背景下，接入网、承载网和核心网的重构和重建均将带来 PCB 的增量需求。

根据 PrismaMark 预计，2019 年全球通信设备市场规模为 5,910 亿美元，受贸易战等宏观因素影响，较 2018 年的 5,920 亿美元下降 2.2%，2024 年将回升至 7,100 亿美元。根据 PrismaMark 预计，2019 年全球用于通信设备的 PCB 产值为 205 亿美元，与 2018 年基本相同。全球通信设备的 PCB 需求将由 2019 年的 205 亿美元增长到 2024 年的 271 亿美元，年复合增长率达到 5.7%。

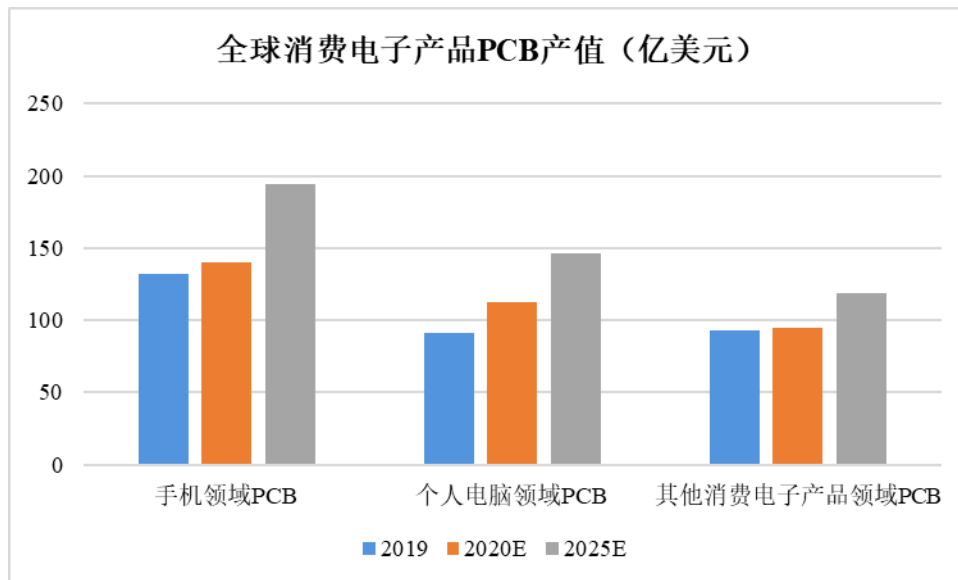


数据来源：PrismaMark

2、消费电子行业稳定增长

随着全球消费升级趋势的展开，消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费，AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、可穿戴设备等消费热点频现，以 AI、IoT、智能家居为代表的创新型消费电子产品层出不穷，各细分领域市场增长潜力可观。

据 Prisma 统计，2019 年全球手机领域 PCB 产值为 132.47 亿元，个人电脑领域 PCB 产值为 91.29 亿美元，其他消费电子领域 PCB 产值（不含手机、个人电脑）为 92.98 亿美元，合计占全球 PCB 产业总产值的比例超过 30%；估计 2020 年全球手机领域 PCB 产值达到 140.1 亿美元，个人电脑领域 PCB 产值达到 112.84 亿美元，其他消费电子领域 PCB 产值（不含手机、个人电脑）达到 94.80 亿美元，并将 2020 至 2025 年之间以 5% 以上的年复合增长率成长。

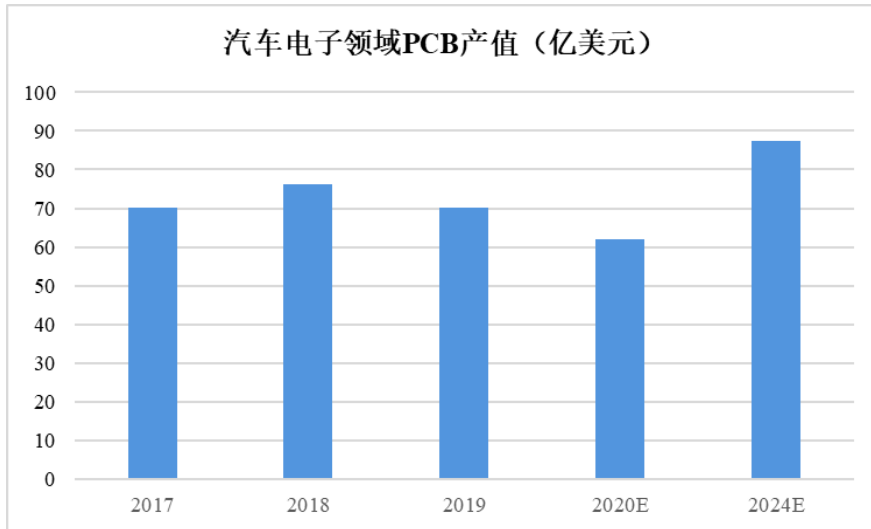


数据来源：Prisma

3、汽车电子推动车用 PCB 市场需求

新能源、自动驾驶等技术推动汽车高度电子化的趋势，汽车电子占比提升拉动车用 PCB 产品需求增长，车用 PCB 产值持续增长，吸引诸多 PCB 厂商积极涉入该领域。目前，一辆中高阶车型的 PCB 产品使用量已达约 30 片，车用 PCB 产品需求增长明显，且较好的客户黏性有利于营收稳定增长。

据 Prisma 统计，2019 年全球汽车电子领域 PCB 产值约 70 亿美元，约占全球 PCB 产业总产值的 12%，预计 2020 年-2024 年将保持 6.8% 的复合增长。



数据来源：Prismark

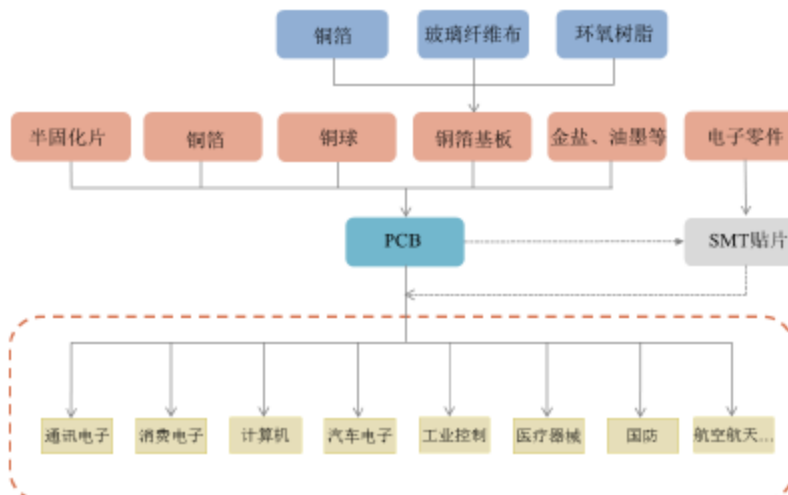
（四）行业利润变动情况

行业利润水平主要取决于上下游行业的变动情况。印制电路板行业的上游产业包括覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、油墨等，上游原材料价格水平决定 PCB 板的生产成本，下游通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、国防、航空航天等行业的波动决定 PCB 板需求和价格水平。覆铜板等原材料成本一般占印制电路板成本的 60%-70%。目前，受益于 5G 通信、新能源汽车等下游行业的驱动，PCB 行业的整体景气度较高。

（五）所处行业与上下游行业之间的关联性

印制电路板产业链上游主要包括覆铜板、铜箔、玻璃纤维布、环氧树脂等原材料的生产及供应商。下游为各类电子产品的生产商，包括通信设备、消费电子、家电、汽车电子、工业控制、医疗、航空航天等领域。

PCB 行业与上下游行业之间的关系如下图所示：



1、与上游行业的关联性

PCB 企业的生产成本直接受到上游原材料价格波动的影响。生产印制电路板所需的原材料主要为覆铜板、铜箔、半固化片及油墨等。

覆铜板被称为基材，系由木浆纸、玻璃纤维布等增强材料浸以树脂，单面或双面覆以铜箔经热压而成的一种产品。覆铜板与 PCB 的品质、性能关系密切，其供应水平和生产技术对 PCB 的制造有显著影响，约占 PCB 原材料成本的 30%-70%；在覆铜板的原材料中，铜箔占其原材料成本 30%-50%。除覆铜板以外，铜箔、铜球等铜制品也是生产印制电路板的重要材料，因此，铜价对印制电路板原材料价格的影响较大，铜价的走高会提高企业的生产成本，印制电路板制造企业较为关注铜价的变化。

2、与下游行业的关联性

PCB 的下游应用领域较为广泛，近年来，下游行业更趋多元化，产品应用覆盖通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等各个领域。PCB 行业与下游行业的发展相互关联、相互促进。一方面，PCB 下游行业良好的发展势头为 PCB 产业的成长奠定了基础，下游行业对 PCB 产品的高系统集成、高性能化不断提出更严格的要求，推动了 PCB 产品朝着“轻、薄、短、小”的方向演进升级；另一方面，PCB 行业的技术革新为下游行业产品的推陈出新提供了可能性，从而进一步满足终端市场需求。

近十年来，全球电子信息产业的长足进步和下游应用领域的不断深化推动 PCB 行业向前发展。通讯、消费电子、汽车电子等领域 PCB 产值占比一直相对较高，未来预计消费电子、汽车电子、工业医疗等下游应用行业，以及更高技术附加值的 HDI 和 IC 封装基板将成为拉动行业增长的主要动力。PCB 产品应用领域还将进一步扩大，市场空间广阔。

（六）行业的周期性、区域性和季节性特征

1、周期性

PCB 行业的周期性受宏观经济波动的影响。随着电子信息产业的不断发展，PCB 行业下游应用领域越来越广泛，涉及通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等众多领域。总体而言，PCB 行业受单个行业波动影响较小，宏观经济波动及电子信息产业整体发展状况对本行

业的影响较大。

2、区域性

从全球角度来看，PCB 产值主要集中在中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国和欧洲等国家或地区。国内 PCB 厂商则主要集中在珠三角、长三角和环渤海地区，其中以珠三角地区最为集中。

3、季节性

目前，PCB 行业下游主要的应用产品集中在通讯电子、汽车电子和消费电子领域。该等产品需求受节假日及消费习惯的影响呈现出一定的季节性，一般上半年为产品销售淡季，下半年为产品销售旺季。通常，PCB 行业的生产旺季早于下游产品的销售旺季。

（七）行业竞争格局

1、境外企业占据主导地位

全球前 20 大 PCB 厂商主要为总部位于境外的企业，如臻鼎、TTM 等。据 Prismark 报告统计显示，在全球前 20 大 PCB 厂商中，台资企业占有 8 家，日本企业有 5 家，中国大陆企业有 2 家。一些境外大型 PCB 厂商目前也来华投资建厂，在生产规模、研发水平、供货能力等方面占有一定优势。

Prismark 统计全球前 20 大 PCB 厂商总部所在国家和地区情况如下：

国家或地区	数量
中国台湾	8
日本	5
韩国	3
中国大陆	2
美国	1
欧洲	1

2、中国大陆增长较快，产品结构趋于高端

中国大陆 PCB 行业起步较晚，中小企业较多，但产值增速快，目前中国大陆的 PCB 行业产值已超过全球行业总产值的 50%。部分具备一定技术实力及规模优势的大陆企业积极布局 HDI、柔性印制电路板及 IC 封装基板等相对高端的 PCB 产品领域，产品结构趋于高端化。

3、同行业企业情况

目前，国内外 PCB 生产制造企业众多，各公司在技术层级、应用领域上存在一定差别，在各自细分市场具有竞争优势。国内同行业上市公司主要概况如下：

单位：亿元

公司名称	主营业务情况	注册地	2020年度经营情况	
			营业收入	净利润
兴森科技	PCB 的研发、生产和销售，主营产品包括 PCB 样板及多品种小批量板，	深圳	40.35	5.22
沪电股份	PCB 的研发、生产和销售，主导产品为通讯市场板、中高阶汽车板、办公及工业设备板等	昆山	74.60	13.43
中京电子	PCB 的研发、生产和销售，产品包括双面板、多层板、HDI	惠州	23.40	1.62
崇达技术	PCB 的研发、生产和销售，主营多层板、HDI 等	深圳	43.68	4.41
奥士康	PCB 的研发、生产和销售，产品以 PCB 硬板，产品层数以双面板和多层板为主	益阳	29.11	3.49
深南电路	PCB 的研发、生产和销售，拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务	深圳	116.00	14.30
景旺电子	PCB 的研发、生产和销售，主营产品为刚性板、挠性板、金属基板等	深圳	70.64	9.21
广东骏亚	PCB 的研发、生产和销售，公司的主要产品包括双面板、多层板等（含 SMT 产品）	惠州	20.66	1.20

资料来源：Wind

三、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）主营业务情况

公司专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品为双面板、多层板（含 HDI）等，产品广泛用于计算机、网络通讯、消费电子、汽车电子、工控安防、医疗仪器等下游领域。

公司是中国印制电路行业协会（CPCA）的副理事长单位，是行业标准的制定单位之一；公司连续多年入围全球著名 PCB 市场调研机构 N.T.InformationLtd 发布的全球印制电路板制造百强企业排名榜，被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、高新技术企业、广东省创新型企业，拥有省、市、区三级工程技术研发中心及省级企业技术中心，科研实力雄厚。

公司工艺技术水平先进，产品质量优良，获得了国内外下游行业客户的青睐。公司客户遍及发展迅速的下游细分朝阳行业，已与富士康、技嘉、海康威视、海信、戴尔、华硕、TCL、德赛西威、台达等百余家客户建立了合作关系。公司产品最终广泛应用于亚马逊、微软、思科、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD 等国内外众多知名品牌。优质客户资源的不断扩展，为公司的进一步发展奠定了良好的基础。

随着产品竞争力的不断提升，公司产品的销售收入稳步增长，国内市场占有率上升，根据 PrismaMark 2021 年 6 月报告，公司位列全球 PCB 供应商第 25 名、中国大陆内资 PCB 厂商第四名。

（二）主要经营模式

公司的经营模式按运营环节可以分为采购模式、生产模式、销售模式。影响公司经营模式的主要因素包括下游客户的需求、上游供应商的服务模式和服务能力、市场竞争情况及国家法律法规政策等因素。报告期内，影响公司主要经营模式的因素未出现重大不利变化趋势。

1、采购模式

公司采购管理中心负责公司主要原材料、辅助原材料和设备采购，主要职能包括建立严谨的供应商管理体系、制定采购流程及制度、采购过程管理控制、成本控制。采购管理中心通过 ERP、SRM 系统建立，达到公开、透明化的采购平台。采购管理中心紧盯业务市场分析、严把客户产品需求、科学合理的控制采购计划，并与关键物料合作厂商签定战略合作协议，确保公司原材料的稳定供应。

2、生产模式

由于不同电子产品对使用的电子元器件有不同的工程设计、电器性能以及质量要求，不同客户的 PCB 产品有所差异，具有定制化特点。公司收到客户订单后，各职能部门依托内部完善的 ERP、MES 系统，快速高效的做出计划安排，准备所需物料、工具、设备、人力进行生产，在公司产能无法满足客户需求时，公司将部分订单的部分生产环节（如钻孔、电镀等）交由其他有资质的企业完成，公司对外协生产的品质和交期进行严格的把控和管理，最终满足客户的需求。

3、销售模式

公司采取“向最终用户直接销售为主、通过贸易商销售为辅”的销售模式。公司一般与主要客户签定框架性买卖合同，约定产品的质量标准和交货方式、结算方式等；客户按需向公司发出具体采购订单，并约定具体技术要求，销售价格、数量等。公司销售分为国内销售和出口销售。

为了更好的服务全球客户，特别是对技术、品质的服务要求高的国际大客户，公司制定了 4S(Sales、CS、QS、TS)销售管理模式。4S 团队能够从多个维度全方位服务客户，从客户审核、NPI 项目导入、量产后的品质保障等方面让客户满意，

最终在赢得高质量订单。为丰富公司客户群和产品结构，公司在北美、欧洲、日本、韩国、台湾、东南亚设立营销分中心，客户开发策略、销售人员管理统一归属公司营销中心。

（三）业务经营资质

公司的生产经营不涉及特殊的经营资质。

（四）核心技术来源

公司自成立以来，一直专注于 PCB 主业发展，注重核心技术投入，目前拥有的核心技术均由公司研发团队通过自主研发获得，属于原始创新技术，处于国内领先水平。公司的核心技术涵盖了多层高精密 PCB 和 HDI 产品的设计、制造（加工制程、设备选型、工艺创新等）和品质控制等各个方面。

（五）主要产品的生产及销售情况

公司专注于 PCB 的研发、生产和销售，产品类型包括双面板、多层板等普通通孔 PCB，以及具有更高线路分布密度的 HDI 板。PCB 是电子元器件的支撑体，主要功能是使各种电子器组件通过绘制的电路进行连接，起到导通和传输的作用；相较于普通的通孔 PCB，HDI 具有更高的线路分布密度，通过使用微孔、盲孔、埋孔等技术，使各层线路内部实现连结，更加契合电子产品轻薄短小的发展趋势。

1、主营业务收入构成情况

（1）按产品构成分析

单位：万元

类别	2021 年 1-3 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
双面板	21,686.34	14.64%	84,832.86	15.93%	80,071.62	21.90%	61,348.13	19.54%
多层板(不含 HDI)	107,685.80	72.70%	403,652.70	75.79%	273,131.76	74.71%	242,663.89	77.29%
HDI	18,752.13	12.66%	44,132.85	8.29%	12,376.32	3.39%	9,960.64	3.17%
合计	148,124.27	100.00%	532,618.42	100.00%	365,579.69	100.00%	313,972.66	100.00%

报告期内，公司的产品以高密度多层线路板为主。报告期各期，公司多层板和 HDI 收入分别为 252,624.53 万元、285,508.08 万元、447,785.55 万元和 126,437.93 万元，占主营业务收入的比例分别为 80.46%、78.10%、84.07% 和 85.36%。

（2）主营业务收入区域分析

单位：万元

销售区域	2021年1-3月		2020年度		2019年度		2018年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
境外	84,561.97	57.09%	324,082.85	60.85%	208,411.94	57.01%	154,255.99	49.13%
境内	63,562.30	42.91%	208,535.56	39.15%	157,167.76	42.99%	159,716.67	50.87%
合计	148,124.27	100.00%	532,618.42	100.00%	365,579.69	100.00%	313,972.66	100.00%

公司的产品销售包括出口和内销两种形式，以出口为主。公司产品直接出口的主要地区为香港、东南亚等，内销主要地区为华南、华东地区。

2、主要产品的产能、产量和销量

报告期内，公司主要产品的产能、产量和销量如下：

单位：万平方米

项目	产品类别	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
产能	双面板和多层板	185	740	600	460
	HDI	12	36	9	5
产量	双面板	44.73	208.65	196.09	145.62
	多层板（不含 HDI）	125.09	466.26	325.30	278.17
	HDI	11.03	25.02	7.33	4.89
销量	双面板	46.65	205.18	189.36	142.93
	多层板（不含 HDI）	125.17	451.20	311.64	276.68
	HDI	10.92	24.43	6.75	4.88
产销率	双面板	104.29%	98.33%	96.56%	98.16%
	多层板（不含 HDI）	100.06%	96.77%	95.80%	99.47%
	HDI	98.97%	97.67%	92.20%	99.79%

注：双面板和多层板均属通孔 PCB，产线可共用，产能合并计算。

（六）原材料和能源供应情况

1、主要原材料采购情况

公司生产所需主要原材料为覆铜板、半固化片、铜球、铜箔等，市场供应充足。报告期内，公司主要原材料采购金额及其占原材料采购总额的比重如下：

单位：万元

项目	2021年1-3月		2020年度		2019年度		2018年度	
	采购金额	占比	采购金额	占比	采购金额	占比	采购金额	占比
覆铜板	41,356.25	42.87%	107,763.05	39.36%	88,723.88	44.28%	67,587.34	41.47%
半固化片	11,616.76	12.04%	32,947.77	12.03%	21,030.43	10.50%	16,327.85	10.02%
铜球	6,539.66	6.78%	21,424.19	7.82%	15,916.59	7.94%	13,107.97	8.04%
铜箔	5,048.04	5.23%	13,887.95	5.07%	9,327.65	4.66%	9,195.55	5.64%
合计	64,560.71	66.92%	176,022.96	64.29%	134,998.55	67.38%	106,218.71	65.17%

注：占比为占原材料采购总额的比例。

公司 PCB 产品成本由直接材料、人工成本和制造费用构成，其中直接材料的占比最大，报告期各期分别为 61.28%、61.26%、63.35%和 64.66%。假设原材料的采购价格变动 $\pm 10\%$ 、 $\pm 20\%$ ，其他因素均不发生变化，原材料采购价格波动对公司主营业务毛利率的影响如下：

主营业务毛利率	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
报告期数据	17.92%	19.97%	22.43%	24.69%
假设原材料平均价格上涨 10%	12.61%	14.90%	17.68%	20.07%
假设原材料平均价格上涨 20%	7.30%	9.83%	12.92%	15.46%
假设原材料平均价格下降 10%	23.22%	25.04%	27.18%	29.30%
假设原材料平均价格下降 20%	28.53%	30.11%	31.93%	33.92%

经上述量化分析可知，假设其他因素均不发生变化，发行人的原材料平均采购价格每上涨 10%，主营业务毛利率平均下降 4-5 个百分点。2021 年一季度，发行人的覆铜板、半固化片、铜球、铜箔四种主要原材料的采购单价分别上涨 23.88%、16.74%、25.10%和 18.03%，主营业务毛利率为 17.92%，较 2019 年、2020 年的 22.43%和 19.97%分别下降 4.51 和 2.05 个百分点。

2、主要能源消耗情况

公司日常生产经营耗用的能源主要为电力，报告期各期，公司电力采购金额分别为 15,357.88 万元、21,656.28 万元、27,954.94 万元和 7,583.33 万元，电力采购金额稳步提高，与公司经营规模扩大、营业收入增加相匹配。

（七）生产经营所需的主要生产设备、房屋

1、固定资产情况

公司的主要固定资产为生产办公用的厂房、生产设备、运输工具和办公设备等，截至 2021 年 3 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋及建筑物	145,553.03	11,962.55	133,590.49	91.78%
机器设备	379,139.47	86,883.92	292,255.55	77.08%
运输工具	4,108.38	2,094.21	2,014.17	49.03%
电子设备及其他	8,408.74	2,968.09	5,440.65	64.70%
合计	537,209.62	103,908.76	433,300.86	80.66%

2、主要生产设备

截至 2021 年 3 月 31 日，公司主要生产设备明细如下：

序号	类别	数量（台/套）	原值（万元）	净值（万元）	成新率
1	钻孔机	869	70,738.68	54,416.87	76.93%
2	曝光机	144	39,291.03	30,773.57	78.32%
3	VCP 线	35	19,731.80	15,365.40	77.87%
4	成型机	250	14,173.57	9,925.57	70.03%
5	测试机	149	12,215.70	9,728.73	79.64%
6	镭射钻孔机	32	11,554.37	9,342.14	80.85%
7	液压多层真空热/冷压机	28	8,410.25	6,698.36	79.65%
8	水平沉铜线	25	8,039.69	6,331.68	78.76%
9	印刷机	80	6,271.88	4,390.72	70.01%
10	磨边机	30	5,871.23	4,702.33	80.09%
11	真空蚀刻机	10	5,010.59	4,633.81	92.48%
12	DES 显影蚀刻连退膜机	26	4,096.29	2,837.13	69.26%
13	压合自动拆解叠合线	14	3,943.59	3,258.43	82.63%
14	自动光学检测机	36	3,789.05	3,126.68	82.52%
15	研磨机	114	3,719.02	2,792.67	75.09%
16	冰水机	34	3,473.26	2,711.11	78.06%
17	冲孔机	24	3,458.02	2,493.28	72.10%
18	前处理机	50	3,196.64	2,480.94	77.61%
19	等离子除胶机	15	2,998.15	2,748.96	91.69%
20	外观检查机	43	2,824.80	2,270.99	80.39%
21	斜边机	27	2,652.78	2,216.39	83.55%
22	钻靶机	32	2,612.31	1,920.19	73.51%
23	熔合机	55	2,485.23	1,921.97	77.34%
24	隧道炉	26	2,245.23	1,813.45	80.77%
25	涂布线	17	2,112.81	1,297.16	61.40%
26	棕化机	21	1,939.28	1,664.54	85.83%
27	飞针测试机	31	1,423.18	979.52	68.83%
28	压机真空机组	18	1,402.27	577.29	41.17%
29	真空树脂塞孔机	8	1,043.42	963.22	92.31%
30	裁切机	25	835.93	626.07	74.90%
31	包装线	7	775.73	658.64	84.91%
32	V-CUT 机	26	714.10	540.56	75.70%
33	成型清洗机	17	531.33	382.41	71.97%
34	光绘机	5	492.37	235.29	47.79%
35	镀铜线	1	371.23	18.56	5.00%
36	开料机	10	309.43	226.08	73.06%
37	拆解回流生产线	1	305.59	15.28	5.00%
38	烤箱	37	277.79	245.23	88.28%

序号	类别	数量（台/套）	原值（万元）	净值（万元）	成新率
39	拆解叠合回流线	1	239.32	21.44	8.96%
40	退锡机	2	217.33	101.28	46.60%
41	PTH 前磨板机	9	209.30	161.18	77.01%
42	X-RAY 多层板检查机	14	180.94	143.53	79.32%
43	化金线	2	156.92	132.87	84.68%
44	单轴 PP 钻孔机	5	148.77	128.19	86.17%
45	割胶机	3	128.46	16.15	12.57%
合计		2,408	256,618.67	198,035.85	77.17%

公司生产设备主要分布于母公司，少部分由子公司胜华电子等所有和使用。

3、主要房屋建筑物

截至 2021 年 8 月 17 日，公司拥有的房屋所有权情况如下：

序号	权利人	房产证号	房屋坐落	用途	面积（㎡）	取得方式
1	胜宏科技	粤房地权证惠州字第 1110065196 号	广东惠州淡水新桥村行诚科技园胜宏厂 A1 栋（一期厂房）	多层板生产车间及办公室	31,652.26	自建
2	胜宏科技	粤房地权证惠州字第 1110065214 号	广东惠州淡水新桥村行诚科技园胜宏厂 C1 栋（员工宿舍）	员工宿舍	13,851.77	自建
3	胜宏科技	粤房地权证惠州字第 1110065212 号	广东惠州淡水新桥村行诚科技园胜宏厂 B1 栋（辅助楼）	多层板生产车间及辅助车间	16,728.58	自建
4	胜宏科技	粤房地权证惠州字第 1110065213 号	广东惠州淡水新桥村行诚科技园胜宏厂 B2 栋（仓库）	仓库	16,608.16	自建
5	胜宏科技	粤（2017）惠东县不动产权第 0024501、0024347、0024503、0024467、0024455、0024470、0024472、002365、0024505、0024516 号	巽寮村海滨公路下侧海公元商住小区 J 栋 12 层 01-10 号房	住宅	合计 736.94	购买

截至 2021 年 8 月 17 日，公司购自惠州市惠阳雅居乐房地产开发有限公司的 2 栋员工宿舍（惠州市惠阳区淡水街道新桥村排浪地段新乐大道 10 号珑禧花园 4 幢、6 幢），产权证书正在办理中，该等员工宿舍因购房按揭贷款而存在抵押情形；此外，公司自建的 7 栋房屋正在办理产权证书，具体如下：

序号	权利人	房屋坐落	用途	面积（㎡）
1	胜宏科技	广东惠州淡水新桥村行诚科技园胜宏厂 C 栋（干部公寓）	员工宿舍	7,384.00
2	胜宏科技	广东惠州淡水新桥村行诚科技园胜宏厂 D 栋（干部公寓）	员工宿舍	7,400.00
3	胜宏科技	广东惠州淡水新桥村行诚科技园胜宏厂 A3 栋（厂房三）	多层板智慧车间	67,825.69

序号	权利人	房屋坐落	用途	面积（m ² ）
4	胜宏科技	广东惠州淡水新桥村行诚科技园胜宏厂 A2 栋（厂房二）	HDI 生产车间	86,360.00
5	胜宏科技	广东惠州淡水新桥村行诚科技园胜宏厂 A5 栋（厂房五）	钻孔车间	16,728.58
6	胜宏科技	广东惠州淡水新桥村行诚科技园胜宏厂仓库二	立体仓库	34,130.00
7	胜宏科技	广东惠州淡水新桥村行诚科技园研发中心	研发办公	39,049.00

公司主要生产设备和房屋的使用情况良好，除了购买的员工宿舍因购房按揭贷款存在抵押情形外，不存在其他权利受限情形。

四、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）公司经营理念

公司秉持“科学发展，创新高效，和谐共赢，打造名牌”的企业理念，围绕“四化”：智能化、绿色化、精致化、服务化和“五好”：建设好团队、理清好思路、树立好品牌、健全好制度、打造好文化，解决好五对辩证关系——产能与品质双轮驱动、战略和执行双拳出击、严管与厚爱双管齐下、改革和发展双足并进、服务与效益双向共赢，为股东创价值，为员工谋福祉，为社会添效益，走向更广更远的未来。

（二）发展战略

公司将以市场为导向，以目前所拥有的管理、研发、技术、产品、客户资源优势为依托，推动落实智慧工厂、绿色制造和高技术、高品质、高质量服务三大战略，通过全面提升生产规模、技术与产品创新能力、市场开拓力度以及完善法人治理结构等方式，进一步强化公司核心竞争能力，使公司发展成为一家高速增长并兼具市场影响力的 PCB 行业名牌企业，成为推动行业技术进步与产品结构升级的领导者。

（三）未来三年业务发展规划

公司经过十几年的发展，锐意进取，不断开拓，目前已发展成一家专业从事印制电路板研发、生产和销售业务的国家高新技术企业。近年来，公司依托良好的外部市场环境，业务发展形势良好。

未来三年，公司主要任务是夯实公司内部实力，进行公司的管理流程优化，推进信息化建设；以现有产品为基础，不断加大新产品的研制和开发，推进产品战略，提升产品的档次和附加值，加快公司在目标市场的重要客户的引入，提升公司在目标市场的影响力；进一步扩大品质稳定的优势，持续提升公司的营运能

力，提升准时交货率；继续加大研发投入，加强与国内大学、专业研究机构及厂家的合作，及时把握国内及国际市场技术开发的最新动态，提升公司研发实力；推进人力资源开发计划，引进各类人才，优化人才结构；同时充分利用资本市场的融资功能，扩大现有产品的生产能力，加快新产品的开发进度，积极开拓行业前沿应用领域，使公司产品更好地适应国内外市场需求，不断加强公司的核心竞争力和提升公司的盈利能力，实现业务收入和利润的持续快速增长。

五、财务性投资情况

自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资情况，不存在类金融业务。

2021年3月末，公司衍生金融工具余额为1,857.02万元，系公司与银行签订的远期结汇/售汇协议项下尚未交割结汇的外币。外汇套期保值业务与公司生产经营及主营业务密切相关，故不属于财务性投资。

六、未决诉讼、仲裁等事项

截至2021年8月17日，公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼或仲裁事项。

七、行政处罚情况

报告期内，公司遵守国家的有关法律与法规，合法经营，不存在重大违法违规的行为。报告期内，公司存在的行政处罚情形如下：

2019年4月12日，发行人子公司胜宏研究院因未按期申报残疾人就业保障金，被国家税务总局惠州市惠阳区税务局第一税务分局处以200元罚款（税务处罚决定书文号：惠阳一税简罚[2019]150408号）；2019年10月1日，发行人子公司胜宏研究院因逾期办理所得税、增值税等税种的申报，被国家税务总局惠州市惠阳区税务局淡水税务分局处以500元罚款（税务处罚决定书文号：惠阳淡水税简罚[2019]150281号）。发行人已缴纳罚款。上述处罚金额较小，处罚额度属于《广东省税务系统税务行政处罚裁量基准》规定的违法程度“较轻”的处罚基准范围，不属于《中华人民共和国税收征管法》规定的违法情节严重情形，不属于重大违法行为，该项处罚不构成本次发行的实质性法律障碍。

第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

公司是一家专业从事 PCB（高精密度线路板、HDI）研发、设计、制造和销售的高新技术企业，产品广泛用于计算机、网络通讯、消费电子、汽车电子、工控安防、医疗仪器等领域，产品获得亚马逊、微软、思科、Facebook、谷歌、中兴、富士康等知名客户或终端品牌的认证，目前位列全球 PCB 供应商第 25 名。

1、PCB 行业持续健康发展、行业市场广阔

根据 PCB 行业研究机构 Prismark 统计，2020 年全球 PCB 总产值约为 652.19 亿美元，同比增长 6.4%，全球 PCB 市场规模在未来五年仍将保持稳步增长的趋势，预计到 2025 年全球 PCB 市场规模将达 863 亿美元；中国大陆 2020 年 PCB 总产值约为 350.54 亿美元，同比增长 6.4%，到 2025 年中国大陆 PCB 总产值规模预计达到 461.2 亿美元，2020-2025 年均复合增长率为 5.6%。

2、产业政策大力支持 PCB 产业发展

电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，与国民经济发展和国家安全密切相关，PCB 作为现代电子设备中的重要电子元器件之一，在电子信息产业链中发挥关键性作用，近年来政府出台一系列政策大力鼓励和扶持 PCB 行业发展。同时，随着工业 4.0 概念和中国制造 2025 的提出和发展，促使行业不断向高端工业化、智能化发展，从而推动产业升级进步。

3、5G 通信、消费电子、汽车电子等应用领域的蓬勃发展催生 PCB 巨大市场需求

（1）5G 商用时代的来临，为 PCB 行业打开市场空间

国家对新一代信息技术十分重视，在《中国制造 2025》和“十三五”规划纲要等文件中，均将 5G 技术列为战略重点发展领域。相对于“1G 空白、2G 跟随、3G 突破、4G 同步”的发展历程，中国 PCB 企业已在 5G 领域宏基站与微基站的天线/射频模块、光通信模块、新型封装工艺等方面掌握核心技术，可以与国外企业进行高纬度竞争。随着 5G 的规模化应用，将带来电子信息产业的重大变革，从前期的宏基站与微基站建设、交换机与路由器升级、服务器与存储器置换，

到后期的智能终端、大数据、人工智能、物联网等应用，为我国 PCB 企业在技术上提供赶超赛道，为 PCB 市场提供广阔的成长空间。

根据中国信息通信研究院发布的《5G 经济社会影响白皮书》，按照 2020 年 5G 正式商用算起，预计当年将带动约 4,840 亿元的直接产出，2025 年和 2030 年将分别增长到 3.3 万亿和 6.3 万亿元，十年间的年均复合增长率为 29%。

（2）消费电子产品的持续创新促进 PCB 需求的增长

随着全球消费升级趋势的展开，消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费，AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、可穿戴设备等消费热点频现，以 AI、IoT、智能家居为代表的创新型消费电子产品层出不穷，各细分领域市场增长潜力较大，消费电子产品的持续创新将促进其对 PCB 的需求。据 PrismaMark 统计，2019 年消费电子行业电子产品产值达到 2,980 亿美元，预计 2019 年至 2023 年消费电子行业复合增长率为 3.3%。

（3）汽车电子的发展推动车用 PCB 市场需求的扩大

在汽车电子领域，基于物联网背景下的电动汽车、智能汽车、自动驾驶等是汽车行业发展的重要趋势，车用电子搭载率将会进一步上升，车用 PCB 用量也将提升。目前，一辆中高阶车型的 PCB 产品使用量已达约 30 片，车用 PCB 产品需求增长明显，且较好的客户黏性有利于销售的稳定增长。根据 PrismaMark 统计，2019 年全球车用电子产品产值达到 2,250 亿美元，预计 2019 年至 2023 年的复合增长率将达到 2.3%。

4、下游电子产品向便携、轻薄、高性能等方向发展，HDI 板及 IC 封装基板等中高端 PCB 产品的市场需求逐年增大

近年来，智能手机、平板电脑和可穿戴设备等电子产品向小型化、轻薄化和多功能化方向发展，要搭载的元器件数量大大增多，然而留给线路板的空间却越来越有限。在这样的背景下，印制电路板导线宽度、间距，微孔盘的直径和孔中心距离，以及导体层和绝缘层的厚度都在不断下降。HDI 与 IC 封装基板技术，可以在满足终端电子产品性能和效率的标准前提下，使终端电子产品的设计更加小型化。

随着电子产品的更新换代速度加快，HDI 与 IC 封装基板凭借其独特的优势，更加符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势，在电子信息产业领域扮

演了愈加重要的基石角色，逐渐成为笔记本电脑、智能手机、平板电脑、数码相机等消费电子产品不可或缺的元器件。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、推进公司经营规模的扩大和发展战略实施，优化产品结构

公司所处 PCB 行业属于国家政策鼓励的产业。经过多年积累，公司优质的产品和服务在市场上形成了良好的口碑。当前，国家对电子信息行业的大力扶持，下游 5G 通信、消费电子、汽车电子等市场快速增长。面对这一良好的市场发展机遇，公司将紧跟 PCB 行业最新技术的发展，加大研发投入，扩大经营规模、积极开拓行业前沿应用领域，使公司产品更好地适应国内外市场需求，不断加强公司的核心竞争力。本次募集资金到位后，公司将建设完成高端多层板、高阶 HDI 和 IC 封装基板自动化生产工厂，改善产品结构，进一步提高公司产品的市场占有率。

2、优化资本结构，缓解营运资金压力

近年来，随着生产研发和市场开发的持续投入，公司对流动资金的需求进一步提高，公司资产负债率逐渐升高，流动性减弱，资本实力在一定程度上影响了公司的竞争实力。为了满足公司发展需要，公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金，补充公司主营业务发展所需的营运资金，缓解资金压力，降低资产负债率，改善公司的资本结构，提高公司抗风险能力，进而提升盈利能力与经营稳健性，实现公司的可持续发展。

此外，资金实力的增强将为公司经营带来有力的支持，公司将在研发能力、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，增强公司核心竞争力，实现快速发展。

二、发行对象及其与发行人的关系

本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

公司本次向特定对象发行股票已获得深交所上市审核中心审核通过，最终发行对象将在本次发行经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的 A 股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）定价方式和发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

调整公式如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则：

派息： $P_1=P_0-D$

送股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

公司本次向特定对象发行股票已获得深交所上市审核中心审核通过，最终发行价格将在本次发行经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据询价情况协商确定。

（二）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量不超过发行前股本总额的 30%，即不超过 233,268,436 股（含本数）。本次向特定对象发行股票已获得深交所上市审核中心审核通过，在上述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会授权，在本次

发行申请完成中国证监会注册后，根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（三）限售期

本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行对象所取得的公司股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定。

四、募集资金投向

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟用本次募集资金投入
1	高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目	298,946.52	150,000.00
2	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00
合计		348,946.52	200,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决；为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

五、本次发行是否构成关联交易

截至 2021 年 8 月 17 日，本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

本次发行前，公司控股股东为深圳胜华，持有公司 20.65% 的股份；实际控

制人为陈涛先生，其持有深圳胜华 90%的股权并间接持有香港胜宏 70%的股权，合计控制公司 37.55%的表决权，为公司实际控制人。

本次向特定对象发行股票数量不超过 233,268,436 股，以上限 233,268,436 股计算，本次发行完成后，控股股东深圳胜华持有公司 15.88%的股权，陈涛先生控制公司 28.88%的表决权，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变更。

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次向特定对象发行的相关事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过。且本次向特定对象发行已经深圳证券交易所审核通过，尚需经中国证监会注册。

在经中国证监会注册后，公司将依法实施本次发行，并向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，履行本次向特定对象发行股票的相关程序。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟用本次募集资金投入
1	高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目	298,946.52	150,000.00
2	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00
合计		348,946.52	200,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决；为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析

（一）高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目

1、建设项目的基本情况及经营前景

（1）项目基本情况

公司高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目计划总投资 298,946.52 万元，其中拟以募集资金投入 150,000.00 万元，用于项目建设投资，由子公司南通胜宏科技有限公司实施，实施地点为南通市海门经济技术开发区滨江工业城苏州路北、扬子江路东。本项目的建设期为 24 个月。

（2）投资概算

本项目计划总投资 298,946.52 万元，其中建设投资 285,284.02 万元，铺底流动资金 13,662.49 万元，本次募集资金全部用于资本性支出项目。项目具体投资构成明细如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	比例
1	建筑工程费	46,007.70	15.39%

2	设备购置费	225,085.15	75.29%
3	设备安装费	4,501.70	1.51%
4	工程其他费用	1,380.23	0.46%
5	预备费	8,309.24	2.78%
6	铺底流动资金	13,662.49	4.57%
合计		298,946.52	100.00%

①建筑工程费

本项目建设工程费的测算如下：

序号	项目	建筑面积 (m ²)	基建单价 (元/m ²)	装修单价 (元/m ²)	金额 (万元)
1	多层板	50,000.00	1,612.23	2,012.65	18,124.40
2	HDI	40,000.00	1,587.34	2,601.84	16,756.72
3	IC 封装基板	20,000.00	1,605.67	3,957.62	11,126.58
合计		110,000.00	-	-	46,007.70

②设备购置费

多层板和 HDI 板的设备重合度和相似度较高，IC 封装基板的设备基本为专有设备，本项目设备购置费分高端多层板和高阶 HDI、IC 封装基板两部分测算，具体如下：

产品类型	序号	设备名称	数量 (台/套)	金额 (万元)
高端多层板、高阶 HDI	1	激光钻孔机	70	23,870.00
	2	钻孔机	270	18,318.80
	3	VCP 烘干一体线	10	18,015.30
	4	LDI 连线	21	17,774.85
	5	VCP 填孔电镀线	4	8,184.00
	6	压机	16	7,604.00
	7	真空蚀刻机	9	5,063.84
	8	水平 PTH 线	11	4,565.81
	9	等离子除胶机	14	2,895.87
	10	CNC 机	48	2,829.46
	11	AGV	300	2,066.74
	12	脉冲 D-VCP 线	2	1,390.13
	13	自动研磨机	27	1,300.94
	14	四线测试机	3	1,213.79
	15	连线冲孔机	6	1,148.31
	16	自动裁磨线	3	1,077.12
	17	其他	-	27,546.69
	小计			144,865.65
IC 封装基板	1	VCP 烘干一体线	5	12,600.00
	2	LDI 曝光机	6	10,205.00
	3	飞针测试机	23	9,409.00
	4	治具电测机	17	9,376.00

	5	激光钻孔机	17	8,500.00
	6	水平 PTH 线+水平闪镀	2	5,200.00
	7	外观检查机	10	2,980.00
	8	垂直 PTH 线	1	2,600.00
	9	AOI 线	4	1,580.00
	10	ABF 压膜机	2	1,262.00
	11	其他	-	16,507.50
		小计	-	80,219.50
		合计		225,085.15

③设备安装费

本项目设备安装费按照设备购置费的 2% 计取，设备安装费金额为 4,501.70 万元。

④工程其他费用

本项目工程其他费用按照建筑工程费的 3% 计取，工程其他费用金额为 1,380.23 万元。

⑤预备费

本项目预备费按照建筑工程费、设备购置费、设备安装费和工程其他费用之和的 3% 计取，预备费金额为 8,309.24 万元。

⑥铺底流动资金

公司结合募投项目的预计收入规模及各项资产、负债的周转情况对流动资金需求进行估算，根据产品生产、原材料储备等需要，并考虑产品销售情况和应收帐款、应付帐款收支状况，参照企业现有实际水平，铺底流动资金占项目达产后流动资金的 30%，本项目所需铺底流动资金 13,662.49 万元。

上述各项投资支出均为项目建设的必要支出，测算过程合理。

(3) 经济效益测算

①经济效益测算过程

本项目建设期 2 年。项目达产后，预计年均实现销售收入 436,500.00 万元，年均实现净利润 55,830.19 万元，效益测算过程如下：

单位：万元

项目	T3 年	T4 年	T5 年	T12 年
营业收入	218,250.00	436,500.00	436,500.00		436,500.00
营业成本	158,238.26	316,476.52	316,476.52		316,476.52
税金及附加	1,726.11	3,452.22	3,452.22		3,452.22
经营利润	58,285.63	116,571.26	116,571.26		116,571.26

销售费用	4,476.88	8,953.75	8,953.75		8,953.75
管理费用	7,970.09	15,940.18	15,940.18		15,940.18
研发费用	8,618.54	17,237.08	17,237.08		17,237.08
财务费用	-	-	-		-
利润总额	37,220.12	74,440.25	74,440.25		74,440.25
所得税费用	9,305.03	18,610.06	18,610.06		18,610.06
净利润	27,915.09	55,830.19	55,830.19		55,830.19

A.营业收入

项目主要产品为高端多层板、高阶 HDI 和 IC 封装基板三大类，产品价格以公司现有相同或类似结构产品单价及当前市场价格作为主要测算依据，销售数量根据所建工厂的配套生产能力及未来市场需求预计来估算。建设期第 3 年预计达产 50%，建设期第 4 年全部达产，项目计算期内，达产后年销售收入 436,500.00 万元。

B.营业成本

项目营业成本包括原材料消耗费、直接人工费、制造费用、折旧费和燃料及动力费等。原材料消耗费参考主要原材料的市场现有价格；直接人工费根据项目拟投入人员数量，参照目前公司年平均工资测算；制造费用中折旧费根据项目新增固定资产金额，参考公司现行的会计政策计提，其他制造费用根据公司历史财务数据进行测算。项目计算期内，达产后年营业成本为 316,476.52 万元。

C.税金及附加

项目税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加，增值税税率为 13%、城市维护建设税税率为 7%、教育费附加税率为 3%、地方教育费附加税率为 2%。项目计算期内，达产后年税金及附加为 3,452.22 万元。

D.期间费用

项目期间费用中的人工工资及福利根据项目拟投入人员数量，参照目前公司年平均工资测算，其他费用根据公司历史财务数据中各项费用占营业收入的比例进行测算。项目计算期内，达产后年销售费用为 8,953.75 万元，管理费用为 15,940.18 万元，研发费用为 17,237.08 万元。

E.现金流量分析

项目计算期内，T3 年现金流入为 218,250.00 万元，T4 年-T12 年现金流入为 436,500.00 万元/年；T1-T4 年现金流出分别为 105,109.03 万元、180,174.99

万元、175,498.84 万元和 345,623.34 万元，T5 年-T12 年现金流出为 338,792.09 万元/年。

公司选用市场较为通行的 12% 作为折现率。经测算，项目静态投资回收期为 6.27 年（所得税后，含建设期），税后投资内部收益率为 19.49%。

②效益指标的合理性

A.募投项目与公司报告期毛利率对比

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度	报告期平均值	募投项目 达产年
毛利率	22.49%	23.66%	25.75%	27.56%	24.87%	27.50%

项目达产年测算的毛利率为 27.50%，略高于公司报告期毛利率平均值 24.87%，主要原因系公司募投项目产品在原有多层板基础上，增加了更高端的高阶 HDI 和 IC 封装基板。

募投项目达产年测算的毛利率与公司经营情况相匹配，效益指标测算合理。

B.募投项目效益测算与可比项目对比

公司与同行业可比公司过往募投建设项目对比情况如下：

公司名称	项目	达产年 毛利率	内部投资 收益率（税后）	静态投资 回收期（税后）
明阳电路	年产 36 万平方米高频高速印制电路板	26.40%	17.38%	7.05
崇达技术	年产 270 万平方米多层板项目	28.26%	12.41%	7.82
景旺电子	年产 120 万平方米多层印刷电路板项目	28.55%	12.76%	7.88
深南电路	半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	-	13.93%	7.10
	数通用高速高密度多层印制电路板 投资项目（二期）	29.72%	11.11%	7.19
超声电子	新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目	28.45%	15.36%	7.79
科翔股份	江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）	-	-	6.81
世运电路	年产 300 万平方米线路板新建项目（一期）	26.79%	-	-
兴森科技	二期工程建设项目—刚性电路板项目	-	10.21%	7.17
	广州兴森集成电路封装基板项目	-	8.76%	7.09
	年产 96 万平方米印刷线路板项目	-	16.53%	7.13
胜宏科技	高端多层、高阶 HDI 印制线路板 及 IC 封装基板建设项目	27.50%	19.49%	6.27

公司本次募投项目毛利率与行业平均水平一致，内部投资收益率和静态投资回收期指标优于行业平均水平，募投项目效益测算合理。

（4）本次募投项目的具体内容，与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系

①本次募投项目的具体内容

本次募投项目拟新建高端多层板产能 145 万 m²/年、高阶 HDI 40 万 m²/年、IC 封装基板 14 万 m²/年，系对公司现有产品结构的升级。

②本次募投项目与公司既有业务的区别和联系

公司现有产品类型主要为多层板和 HDI，其中 HDI 板产能较小，按二阶计算的 HDI 年产能约为 48 万平方米。本次募投项目在扩充现有优势产品多层板、HDI 产能的基础上，产品平均设计层/阶数提高，新增 IC 封装基板产品，工艺水平更加先进，技术附加值更高。本次募投项目的目标客户群体与现有业务基本一致，其中新增产品 IC 封装基板的部分目标客户亦系发行人现有产品的合作厂商。

③本次募投项目与前次募投项目的区别和联系

公司近五年内的募投项目为 2017 年度非公开发行股票之募投项目。本次募投项目与前次募投项目的区别和联系主要如下：

项目类型	前次募投项目	本次募投项目
项目名称	新能源汽车及物联网线路板项目	高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目
实施主体	胜宏科技	南通胜宏
设计产品类型	多层板	多层板、高阶 HDI、IC 封装基板
产品特性	生产产品为普通多层板，系满足新能源汽车及物联网领域应用要求的通孔板。	相较于前次募投项目，本次拟建多层板的平均设计层数更高，产品综合性能和品质更优良。
		相较于普通多层板，HDI 具有更高的线路分布密度，更高的电、热性能，有利于实现产品轻薄化，高阶 HDI 则代表了 HDI 产品的先进方向。
		IC 封装基板是一种承载封装半导体裸芯片的基材，建立芯片与 PCB 之间的讯号连接，还有保护电路、设计散热途径、建立零组件模块化标准等附加功能，相较于 HDI，该产品拥有更好的尺寸稳定性，线路密度更高，更具微型化特点。
应用领域	主要应用于通信、计算机、汽车电子等行业。	高端多层板的主要应用领域与前次募投项目基本相同，但可满足更高等级的应用需求，在同一应用领域的具体应用场景有所提升。
		HDI 目前在消费电子和汽车电子领域的应用居多，高阶 HDI 满足更高密度、小型化的封装要求，渗透率逐渐提升。
		IC 封装基板与多层板基本为互补品，用 IC 封装基板完成芯片封装后，还需多层板用以电路传输及承载，应用领域包括消费电子、通信、汽车电子等。
生产工艺	使用普通 PCB 的典型生产工艺，用环氧树脂和电子级玻璃	高端多层板的生产工艺与前次募投项目基本相同，工艺控制能力要求更高。
		高阶 HDI 不同于普通 PCB 的通孔板工艺，使用微孔、盲孔、埋孔等

	布压合而成，压合后钻孔电镀，制得通孔板	技术，采用积层法制造，盲孔电镀后二次压合，同时采用叠孔、电镀填孔、激光直接打孔等先进 PCB 技术，积层的次数越多，即阶数越高，技术难度越高。 IC 封装基板的制作技术难度相较多层板、HDI 更高，使用 BT、ABF 等高端封装材料，不同于普通 PCB 的减成法，其生产工艺采用半加成（mSAP）和全加成（SAP）法，用于加工更精细、更小间距等级的产品，以满足芯片产品的需求。
客户群体	通信、计算机、汽车电子等领域的厂商	本次募投项目的目标客户群体与前次募投项目基本一致，其中新增产品 IC 封装基板的部分目标客户已系发行人现有产品的合作厂商。

(5) 本次募投项目建成之后的营运模式、盈利模式，是否需要持续的大额资金投入

本次募投项目建成后，公司的营运模式和盈利模式不会发生重大变化，依托规范的供应商管理制度，严格把控原材料品质，依据订单安排生产，通过研发、生产 PCB 产品并销售获取利润，不需要持续的大额资金投入。

(6) 拓展新业务的原因，新业务与既有业务的发展安排

本次募投项目在扩充现有优势产品产能的基础上，对产品结构进行升级，主要系为顺应行业发展趋势的需要，扩充高端产品产能，满足优质战略客户需求，巩固行业地位，提高高端市场占有率。

本次募投项目的实施主体为子公司南通胜宏，项目建成后，将对公司现有产能，尤其是高端产品产能，形成有力补充，与公司既有业务共同发展，共同服务于客户的多种类产品需求。

2、项目建设的必要性及与发展战略的关系

(1) 优化公司产品结构，顺应行业发展趋势的需要

2020 年，全球 PCB 市场规模达到约 650 亿美金；Prismark 的最新预测数据显示，2021 年全球 PCB 市场规模将同比增长 14%，达到 740 亿美金，增长动力主要来自于通信、消费电子、电动汽车等领域的市场需求扩大，以及技术升级和供应链恢复。

从产品结构来看，多层板一直保持重要的市场地位，占据近 40% 的市场份额。根据 Prismark 预计，2025 年全球多层板产值将超过 300 亿美元。除了 5G 通信、物联网等因素的驱动，近年来新能源汽车行业的快速发展推动汽车板的用量上升。随着汽车电子化率稳步提升，车载动力和各类控制器系统数量的增加，汽车中使用 PCB 板替代线缆的趋势愈加显著；而由于部分车载 PCB 的性能与驾驶

安全息息相关，车载 PCB 的可靠性至关重要，平均价值量较高。据 Prisma 预测，2024 年，全球车载 PCB 产值有望超过 87 亿美元。

HDI 和 IC 封装基板作为更高技术含量、更高附加值产品，近年来增速较快，根据 Prisma 统计，2020 年度 HDI 市场规模约为 100 亿美元，IC 封装基板市场规模约为 102 亿美元，预计 2020 年至 2025 年的年均复合增长率分别为 6.7%、9.7%。HDI 系移动终端内占比最大的 PCB 类型，占比超过 40%，由于 5G 所要求的更高集成化度，以及消费电子持续的轻薄便携化，HDI 逐渐由低阶向高阶升级。IC 封装基板是半导体材料中最重要的材料之一，在半导体封装材料之中的成本占比达到约 40%。随着晶圆制造技术的演进，对于晶圆布线密度、传输速率及讯号干扰等性能提出了更高的要求，直接推动了 IC 封装基板市场规模的增长。

目前，全球高端 PCB 产品市场由海外企业主导，但由于中美贸易摩擦及中国电子品牌市场份额持续扩大，高端 PCB 产品市场的国产化替代需求强烈。公司近年来产品结构不断改善，但现有产能已不能满足日益升级的市场需求，为保持良好的市场竞争力，公司高端产品产能的扩充迫在眉睫。本次募投项目拟生产产品包括高端多层板、高阶 HDI 和 IC 封装基板，实施后可以进一步优化现有的产品结构，顺应行业未来发展趋势。

（2）扩充高端产品产能，满足优质战略客户需求

公司积极推进优质大客户战略，现有客户数量已达数百家，基本覆盖各下游领域头部厂商或品牌，包括富士康、技嘉、海康威视、台达、广达等厂商，以及亚马逊、微软、思科、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、戴尔、华硕、日立、SKY 等国内外知名品牌，该等客户的 PCB 采购需求量大，与公司的合作规模均存在较大成长空间，合作产品种类有望进一步升级。2020 年度，公司新引进大客户 91 家，产品涉及 5G 通信、服务器、新能源、车载、消费电子、光电等各个领域。目前公司在手订单充足，下游需求良好。

公司现有普通 PCB 和 HDI 产品的产能利用率约为 92%，考虑设备检修等因素的影响，生产线已基本满负荷运转。通过本项目的实施，公司拟新建高端多层板产能 145 万 m^2 /年、高阶 HDI 40 万 m^2 /年、IC 封装基板 14 万 m^2 /年，可以有效扩大高端产品的生产规模，并实现 IC 封装基板的量产，满足优质战略客户需

求，大大提高公司的营收和利润水平。

（3）巩固行业地位，提高高端市场占有率的需要

公司是一家专业从事 PCB（高精密度线路板、HDI）研发、设计、制造和销售的高新技术企业，产品广泛用于计算机、网络通讯、消费电子、汽车电子、工控安防、医疗仪器等领域，产品获得亚马逊、微软、思科、Facebook、谷歌、中兴、富士康等知名客户或终端品牌的认证，目前位列全球 PCB 供应商第 25 名，公司已经发展成为我国印制线路板产品制造领域的领先的企业。

但公司目前的生产规模相对国外的领先生产商还有较大的距离，通过本项目的实施，有利于公司提升和合理配置产能，增加技术含量更高、盈利能力更强的高端多层板、HDI 板和 IC 封装基板的比重，增强公司的核心竞争力，提高高端市场的占有率，巩固公司领先地位，为公司的未来发展奠定良好的基础。

3、项目建设的可行性

（1）不断扩大的市场规模为项目开展提供重要保障

PCB 的下游应用领域较为广泛，近年来下游行业更趋多元化，产品应用覆盖通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等各个领域。PCB 行业与下游行业的发展相互关联、相互促进。一方面，PCB 下游行业良好的发展势头为 PCB 产业的成长奠定了基础，下游行业对 PCB 产品的高系统集成、高性能化不断提出更严格的要求，推动了 PCB 产品朝着“轻、薄、短、小”的方向演进升级；另一方面，PCB 行业的技术革新为下游行业产品的推陈出新提供了可能性，从而进一步满足终端市场需求。

在产品类型上，由于 PCB 行业整体上向高密度、轻薄化方向发展，产品不断缩小体积，轻量轻薄，性能升级，以适应下游不同应用领域的需求，更精密的 HDI 板和封装基板的投入将不断加大。

Prismark 对 2020 年-2025 年全球不同种类 PCB 产值及年增长率预测如下表所示：

单位：亿美元

种类	2019 年 产值	2020 年 产值	2020 年/ 2019 年增长率	2025 年 产值	2025 年 F/ 2020 年增长率
单/双面板	80.9	78.3	-3.20%	93.4	3.60%
多层板	238.8	247.6	3.70%	316.8	5.10%
HDI 板	90.1	99.5	10.50%	137.4	6.70%

挠性板	122	124.8	2.40%	153.6	4.20%
IC 封装基板	81.4	101.9	25.20%	161.9	9.70%
合计	613.1	652.2	6.40%	863.3	5.80%

根据 PrismaMark 统计，2020 年全球单/双面板总产值同比下降 3.2% 的同时，其他 PCB 产品细分领域均呈现不同幅度的增长，其中多层板、挠性板、HDI 板、封装基板在 2020 年总产值分别同比增长 3.7%、2.4%、10.5%、25.2%，IC 封装基板、HDI 板领域业绩增长强劲，市场需求旺盛，关键驱动因素来自计算机行业包括台式、笔记本、平板电脑等产品市场需求旺盛，以及服务器、网络和 AI 设备等计算机基础设施产品发展。据 PrismaMark 预计，IC 封装基板、HDI 板和多层板的增速将明显超过其它 PCB 产品，预计在 2020-2025 年分别实现 9.7%、6.7% 和 5.1% 的复合增长率，高端多层板、HDI 板和 IC 封装基板不断扩大的市场规模为本项目开展提供重要保障。

（2）公司拥有优质客户资源群体

公司凭借先进的生产技术和优异的产品性能，在行业中树立了良好的品牌形象，赢得了较高的市场地位，公司产品已远销韩国、印度、俄罗斯、墨西哥、埃及和东南亚等多个国家和地区，并且在消费电子、通讯、汽车等行业领域积累了一大批稳定合作的优质客户。公司凭借“技术新、品质优、交期快、服务好”在业内树立了良好的声誉，已与富士康、技嘉、海康威视、海信、戴尔、华硕、TCL、德赛西威、台达、广达等百余家客户建立了合作关系。公司产品最终广泛应用于亚马逊、微软、思科、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、日立、SKY 等国内外众多知名品牌。

广泛的客户数量及高品质的客户为公司未来持续发展奠定了良好的市场基础，可以保障本项目的顺利实施。

（3）公司拥有高素质员工团队和研发人员储备

公司多年来专注于印制线路板产品的研发，已经形成了一支专业化的研发团队，积累了大量的技术与经验。截至 2021 年 3 月 31 日，公司拥有专业研发人员 932 人。通过不断的外部招聘和内部培养，公司形成了一支拥有专业水平和实践能力的高素质员工团队，能够为本项目的顺利实施提供保障。

（4）公司拥有深厚的技术储备和先进的生产工艺

公司以市场为导向，保持大力度科研投入，不断改进生产工艺，以先进的

技术工艺水平，搭配全方位优质产品与服务，满足国内外优质战略客户的需求。近年来，公司在行业内率先推行转型升级、率先打造智慧工厂、率先实施绿色制造、率先布局 5G 市场，为企业发展赢得了先机。同时，公司紧盯行业发展前沿，积极布局前沿新技术和新产品，建立先进制程，在高阶 HDI、IC 封装基板等领域拥有多项技术成果和在研项目。

公司拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，获评“高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“全国电子信息行业创新企业”、“广东省知识产权示范企业”、“广东省创新型企业”等荣誉，获评广东省高新技术产品 21 个、市级科技成果登记 8 项，并荣获第二十届、二十一届中国专利优秀奖。公司现有专业研发人员 932 人，科研实力雄厚，拥有线路板领域有效专利 270 项，其中发明专利 80 项，在研项目超 50 个。

4、项目的实施准备和进展情况，预计实施时间，整体进度安排

项目已完成前期的考察论证、项目选址、项目可行性研究报告编制及项目备案工作，相关建设用地已经取得苏（2021）海门区不动产权第 0003612 号不动产权证书，并取得江苏省南通市海门区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》；项目已取得海门经济技术开发区管理委员会出具的《关于〈南通胜宏科技有限公司年产 1200 万平方米多层高密度印刷线路板新建项目环境影响报告表〉的批复》（海开审环[2021]32 号）。项目的建设期为 2 年，具体安排如下：

进度阶段	建设期（月）											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
清理场地	■											
工程及设备招标		■										
改造装修工程		■	■	■								
设备采购及安装调试					■	■	■	■	■	■	■	
人员招聘及培训										■	■	■
试生产											■	■
验收竣工												■

项目资金预计使用进度安排如下：

单位：万元

项目	第一年		第二年	
	总投资	募集资金	总投资	募集资金
建设投资	105,109.03	55,265.47	180,174.99	94,734.53
铺底流动资金	-	-	13,662.49	-

合计	105,109.03	55,265.47	193,837.48	94,734.53
----	------------	-----------	------------	-----------

本次向特定对象发行股份董事会前，公司已购买土地用于实施募投项目，相关支出未包含在募投项目投资构成中。本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，也不存在置换董事会前已投入资金的情形。

5、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

公司多年来专注于印制线路板产品的研发、生产和销售，积累了大量的技术与经验，具备较强的技术研发创新能力和生产管理能力，为项目的顺利实施提供保障。

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决。

6、项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展

截至 2021 年 8 月 17 日，项目已取得江苏省南通市海门区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》；项目已取得海门经济技术开发区管理委员会出具的《关于〈南通胜宏科技有限公司年产 1200 万平方米多层高密度印刷线路板新建项目环境影响报告表〉的批复》（海开审环[2021]32 号）。

（二）补充流动资金和偿还银行贷款项目

1、项目基本情况

公司计划将本次募集资金中的 50,000.00 万元用于补充流动资金和偿还银行贷款，由母公司胜宏科技（惠州）股份有限公司实施，以优化公司财务结构，从而提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。

2、项目的必要性

（1）补充营运资金满足公司业务快速发展的需求

基于行业当前发展趋势和竞争格局的变化，结合公司近年来不断扩大的业务规模，未来几年公司仍处于成长期，生产经营、市场开拓、研发投入等活动中需要大量的营运资金。报告期内，公司营运资金主要通过向银行贷款的方式解决，资金成本压力较大，且借款额度受银行相关政策影响较大，如果没有大量稳定持续的流动资金进行补充，将影响公司的后续发展。受公司业务类型、结算方式等因素的影响，公司应收账款、应收票据、存货的规模较大，对公司日常的运营资

金需求形成了一定压力。

通过本次发行募集资金补充流动资金，可在一定程度上解决公司因业务规模扩张而产生的营运资金需求，缓解快速发展的资金压力，提高公司抗风险能力，增强公司总体竞争力。

（2）降低财务杠杆，增强抗风险能力

为支持发展战略，公司近年来加大投资力度和资本开支规模，资产规模和业务规模不断增加，日常营运资金需求亦不断增加。为了满足业务发展的资金需求，除通过经营活动补充流动资金外，公司还通过银行贷款等外部融资方式筹集资金以满足日常经营之需，充分利用了财务杠杆，为公司的发展提供了有力支持，同时也导致公司资产负债率逐步增高。公司资产负债率、流动比率、速动比率情况如下：

项目	2021-03-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产负债率	63.08%	61.49%	52.44%	44.87%
流动比率	0.76	0.79	0.81	1.08
速动比率	0.58	0.62	0.64	0.91

公司可通过本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金，优化财务结构，降低负债规模，控制经营风险，增强抗风险能力。

3、项目的可行性

（1）本次发行募集资金使用符合相关法律法规的规定

本次向特定对象发行募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，可进一步改善资本结构，降低财务风险；在行业竞争愈发激烈的背景下，营运资金的补充可有效缓解公司经营活动扩展的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。

（2）公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系

公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的公司治理体系，健全了各项规章制度和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。公司已根据相关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

4、补充流动资金的测算过程

（1）基本假设

流动资金占用金额主要受公司经营性流动资产和经营性流动负债影响，公司

预测了 2021 年末、2022 年末和 2023 年末的经营性流动资产和经营性流动负债，并分别计算了各年末的经营性流动资金占用金额（即经营性流动资产和经营性流动负债的差额）。公司未来三年新增流动资金缺口计算公式如下：

新增流动资金缺口=2023 年末流动资金占用金额-2020 年末流动资金占用金额。

（2）测算过程

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2018 年-2020 年 占营业收入的 算术平均值	2021 年度 (E)	2022 年度 (E)	2023 年度 (E)
营业收入	330,394.93	388,461.89	559,960.71	100.00%	728,986.76	949,033.91	1,235,503.05
应收票据、应收账款及应收款项融资	141,592.52	185,116.75	262,295.20	46.06%	335,760.54	437,111.01	569,054.46
预付账款	666.19	1,096.25	2,461.06	0.33%	2,407.59	3,134.33	4,080.44
存货	39,273.39	61,924.82	82,852.55	14.39%	104,917.68	136,587.44	177,816.83
经营性资产合计	181,532.10	248,137.82	347,608.81	60.78%	443,085.81	576,832.78	750,951.73
应付票据及应付账款	196,983.00	260,591.71	343,847.88	62.67%	456,848.96	594,750.39	774,277.83
其中：经营活动相关应付票据及应付账款	117,370.31	171,941.97	276,533.76	44.25%	322,559.13	419,924.71	546,680.42
预收账款及合同负债	58.60	148.36	260.27	0.04%	266.35	346.75	451.41
经营性负债合计	117,428.91	172,090.33	276,794.03	44.28%	322,825.48	420,271.46	547,131.83
经营性资产-经营性负债	64,103.19	76,047.49	70,814.77	16.50%	120,260.33	156,561.33	203,819.90
新增流动资金缺口=2023 年流动资金占用-2020 年流动资金占用= 133,005.12							

注 1：公司未来三年营业收入增长率使用报告期复合增长率 30.19%。

注 2：公司业务模式和结构稳定，假设公司 2021-2023 年不发生重大变化，故未来三年相应经营性资产和经营性负债科目与当年收入的比例一致。

根据上述测算，公司 2021 年-2023 年流动资金缺口预计为 133,005.12 万元，因此，本次募集资金计划使用 50,000.00 万元用于补充流动资金和偿还银行贷款是必要和合理的。

公司高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目的募集资金全部用于资本性支出项目，不存在募集资金用募投项目中预备费、铺底流动资金、支付工资/货款、不符合资本化条件的研发支出等情；用于补充流动资金和偿还

债务的募集资金 50,000.00 万元，不超过募集资金总额的 30%，符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目的实施有利于促进公司现有主营业务的持续健康发展，进一步提高公司的核心竞争能力和总体运营能力，对于扩大公司业务规模、提升公司服务水平、增强公司综合竞争力都将产生积极影响，符合公司长远发展战略。本次募集资金投资项目实施后将进一步提升公司盈利能力，巩固并提高公司在行业内的地位，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

1、增大公司总资产与净资产规模

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将同时增大，有助于增强公司资金实力，为公司后续发展提供有力保障。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产与净资产将相应增加，公司的资本结构将得到优化，公司的资金实力将大幅提升，营运资金会得到有效补充，同时有利于降低公司的财务风险，提高偿债能力，为公司后续发展提供有效保障。

2、提升财务抗风险能力，增强资金实力

本次发行完成后，有利于增强公司的资本实力，财务结构进一步优化，偿债能力显著提高，进一步降低财务风险，保持稳健的财务结构。

四、募集资金使用可行性分析结论

本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体实力及抗风险能力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益，本次向特定对象发行募集资金是必要且可行的。

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后上市公司的业务及资产的变动或整合计划

本次向特定对象发行募集资金在扣除发行费用后拟用于高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目以及补充流动资金和偿还银行贷款，围绕公司主营业务，专注于 PCB 领域，扩大生产规模，改善产品结构，更好地满足市场需求，增强公司资金实力，优化公司财务结构，有利于公司持续健康的发展。

本次向特定对象发行完成后，公司的主营业务保持不变，不会导致公司业务和资产的整合。

二、本次发行后公司控制权结构的变化

本次发行前，陈涛通过深圳市胜华欣业投资有限公司控制公司 20.65% 的股份，通过胜宏科技集团（香港）有限公司控制公司 16.90% 的股份，系上市公司的实际控制人。

本次向特定对象发行股票的数量不超过发行前股本总额的 30%，即不超过 233,268,436 股（含本数）。若本次向特定对象发行按发行数量的上限实施，本次发行完成后公司总股本 1,010,829,891 股，原有股东持股比例将有所稀释；在本次发行后，深圳市胜华欣业投资有限公司持有公司 15.88% 的股份，胜宏科技集团（香港）有限公司持有公司 13.00% 的股份，陈涛控制公司 28.88% 的股份，仍为公司实际控制人。

因此，本次发行不会导致公司控制权结构发生变化。

三、发行后公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

截至 2021 年 8 月 17 日，公司尚未确定本次发行的发行对象，最终确定发行对象时，将对发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务进行背景调查，避免出现上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

四、发行后公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

截至 2021 年 8 月 17 日，公司尚未确定本次发行的发行对象，最终是否存在与发行人存在关联关系的发行对象，以及与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在关联交易的情形，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

第五节 历次募集资金的使用情况

一、前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募集资金到账已满五个会计年度，募集资金已使用完毕并销户。

（二）2017 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]669 号文《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行普通股（A 股）52,938,042.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 20.43 元，募集资金总额人民币 1,081,524,198.06 元，扣除发行费用合计 11,622,140.67 元后的募集资金净额为 1,069,902,057.39 元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于 2017 年 8 月 7 日由其出具了天职业字（2017）15542 号《验资报告》。

为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金实施专户存储，公司、保荐人分别与开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》，报告期内，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已经全部注销。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况

据公司 2017 年度非公开发行股票时披露的募集资金运用方案，本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于“新能源汽车及物联网用线路板项目”。截至 2021 年 3 月 31 日，公司 2017 年度非公开发行股份募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	108,152.42	募集资金净额	106,990.21	
各年度使用募集资金总额	2017 年：32,411.96 万元 2018 年：70,933.33 万元 2019 年：6,159.20 万元			
承诺投资项目	承诺募集资金投资额	实际募集资金投资额	投资进度	项目达到预定可使用状态日期
新能源汽车及物联网用线路板项目	106,990.21	109,504.49	102.35%	2018 年 10 月

公司前次募投项目的进展基本符合预期，募集资金投入使用进度与项目建设进度匹配，公司前次募集资金投资项目未发生变更。

（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（三）临时闲置募集资金用于其他用途情况

根据公司 2017 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司使用不超过人民币 13 亿元（其中 3 亿元为闲置自有资金，10 亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品。

上述决议的授权期内，公司使用募集资金购买了保本型理财产品，累计取得收益 24,672,172.88 元，到期赎回的本金和理财收益均归还募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。

（四）募集资金项目先期投入及置换情况

根据公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，2017 年，公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 18,449.55 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]16198 号的鉴证报告。

（五）前次募集资金未使用完毕的情况说明

截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已经全部注销。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

单位：万元

实际投资项目 项目名称	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累 计实现效 益	是否达到 预计效益
		2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-3 月		
新能源汽车及物联网用 线路板项目	21,980.16	12,452.84	19,379.29	27,285.21	6,086.87	65,508.00	是

（二）前次募集资金使用未达到预计效应的原因

2017 年度非公开发行募投项目“新能源汽车及物联网线路板项目”于 2018 年 10 月建设完成。2018 年实现效益 12,452.84 万元，低于承诺收益，系非公开募投项目投资进度存在延期，未能达到预计收益。

2019 年，公司“新能源汽车及物联网线路板项目”实现效益 19,379.29 万元，略低于承诺收益，系因前次募投项目产能未完全释放，未能达到预计效益。

2020 年，公司“新能源汽车及物联网线路板项目”实现效益 27,285.21 万元，达到预计效益。

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况，不存在前次募集资金投资项目实际效益与承诺效益存在较大差异的情形。

公司前次募投项目的实施环境未发生重大不利变化，不会对本次募投项目的实施产生重大不利影响。

四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

第六节 与本次发行相关的风险因素

一、行业和经营风险

（一）宏观经济波动的风险

公司的主营业务为 PCB 的研发、生产和销售。产品包括双面板、多层板、HDI。作为电子信息产业的一种核心基础组件，PCB 行业的发展与电子信息产业发展以及宏观经济景气度紧密联系，特别是随着电子信息产业市场国际化程度的日益提高，未来 PCB 需求将深受国内、国际两个市场的影响。

从目前经济发展势头来看，受新冠疫情、国际贸易摩擦等影响，国内经济仍面临较大的增速放缓压力，国际经济形势复杂多变，如果国际、国内宏观经济形势以及国家的财政政策、货币政策、贸易政策等宏观政策发生不利变化或调整，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

（二）市场竞争风险

全球 PCB 产业重心逐渐从欧美向亚洲转移，目前已经形成以亚洲（尤其是中国大陆）为主导的新格局，PCB 行业各类生产企业众多，市场竞争较为激烈，但日益呈现“大型化、集中化”的趋势。

如果公司不能充分抓住市场机遇，在产品开发、营销策略等方面及时适应市场需求及竞争状况，公司的市场竞争优势将可能被削弱，并面临市场份额下降的风险或被竞争对手超越的风险。

（三）管理风险

公司已积累了成熟的管理经验并培养出一批管理人才，建立了较为完善的法人治理结构，制订了包括投资决策、信息披露、财务管理、人事管理、关联交易管理、募集资金管理等在内的一系列行之有效的内部控制制度。

公司生产经营规模较大，同时处于业务快速成长期，当前业务发展对公司现有的管理团队提出更高的要求，使得公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面也面临更大的挑战。如公司不能有效落实业务整合战略，同步建立起适应未来发展所需的管理体系，形成更加完善的约束和激励机制，将可能面临一定的经营管理风险。

（四）技术研发风险

随着下游电子消费品等行业产品更新换代的速度加快，印制线路板产品的生产技术更新速度也在同步加快。掌握全面的生产技术、并对生产工艺进行持续的改进，是印制线路板生产企业长期发展的核心竞争力和重要保障。印制线路板各生产企业主要通过在生产实践中研发、积累，形成各自的核心技术。公司一直以来致力于技术研发，被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新技术企业与广东省创新型企业，拥有省、市、区三级工程技术研发中心及省级企业技术中心，科研实力雄厚。若未来本公司无法保持对新技术的吸收应用以及对新产品、新工艺的持续开发，将面临丧失目前技术优势的风险。

（五）原材料供应紧张及价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为覆铜板、半固化片、铜球、铜箔，原材料成本占产品成本比重较高，报告期各期，直接材料占主营业务成本比重分别为 61.28%、61.26%、63.35%和 64.66%。原材料成本是公司产品定价的重要影响因素之一，原材料大幅涨价的情形下，公司会相应提高产品售价，但向下游的传导存在一定滞后。2020 年下半年起，国际铜价开始上涨，叠加下游市场需求复苏等因素的影响，公司主要原材料采购价格波动幅度较大，对公司 2021 年一季度的主营业务毛利率形成负面影响。

2021 年一季度，发行人的覆铜板、半固化片、铜球、铜箔四种主要原材料的采购单价分别上涨 23.88%、16.74%、25.10%和 18.03%，主营业务毛利率为 17.92%，较 2019 年、2020 年的 22.43%和 19.97%下降幅度较大。若未来原材料持续供应紧张、价格持续大幅上涨，而公司不能通过提高产品价格向下游客户转嫁原材料涨价成本，或通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，可能出现原材料供应不足或盈利能力下降等情形，将对公司的经营成果产生不利影响。

（六）应收账款回收风险

近几年，随着公司销售规模持续不断扩大，公司应收账款增长较快，未来公司的应收账款绝对值及应收账款占总资产的比例将可能进一步增长。应收账款的增长将可能导致公司应收账款坏账准备计提金额上涨，从而导致公司经营业绩出现下滑。此外，若公司主要客户的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款可能不能按期收回或无法收回，将给公司带来一定的坏账风险。

（七）债务偿还风险

目前公司长期资产支出较多，银行借款规模较大，资产负债率处于较高水平。截至 2021 年 3 月末，公司短期借款金额为 165,711.40 万元，一年内到期的长期借款金额为 4,178.07 万元，长期借款金额为 94,821.76 万元。如果国家货币政策发生较大变动，或公司未来流动资金不足，未能如期偿还银行借款，可能给公司正常的生产经营造成不利影响。

二、本次发行相关的风险

（一）审批风险

本次向特定对象发行股票已经公司董事会、股东大会审议批准，**已通过深圳证券交易所审核，尚需完成中国证监会注册**，能否取得有关主管部门的批准，以及最终取得上述批准的时间存在不确定性。

（二）发行风险

由于本次发行为向不超过 35 名特定投资者定向发行股票募集资金，发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次向特定对象发行存在发行失败或募集资金不足的风险。

（三）股票市场价格波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响，可能给投资者带来风险。此外，公司本次向特定对象发行需要有关部门审批且需要一定的时间方能完成，在此期间公司股票的市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定风险。

三、募集资金运用的风险

（一）新增产能无法及时消化的风险

发行人现有生产基地 HDI 二期项目即将进入试产阶段，达产后，发行人现有生产基地的产能预计可达 860 万 m²/年。本次募投项目拟新建高端多层板产能 145 万 m²/年、高阶 HDI 40 万 m²/年、IC 封装基板 14 万 m²/年，建成投产后，公司整体产能将出现较大幅度提高，同时固定资产折旧增加较多。本次募投项目系对公司现有产品结构的升级，在客户群体等方面与现有业务存在共通性；但若宏观环境发生不利变化，或者公司市场开拓进展不利，新增产能将存在无法及时

消化的风险，进而影响本次募集资金投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。

（二）募集资金投资项目不能实现预期收益的风险

本次募投项目在扩充现有优势产品多层板、HDI 产能的基础上，对公司现有产品结构进行升级，产品平均设计层数/阶数提高，工艺水平更加先进，技术难度更高，且新增 IC 封装基板产品。公司 IC 封装基板处于研发阶段，目前暂未量产，该产品在所需基材类型、生产工艺、具体应用场景等方面，与公司现有产品存在一定差异，技术壁垒和客户认证壁垒较高。发行人在 PCB 行业已有深厚积累，拥有充足的客户、人才和技术储备，但若新产品 IC 封装基板的研发量产或销售推广进度不达预期，或者项目建设受到市场需求变动、建设进度、研发成果产业化效率等因素的影响，将导致募集资金投资项目不能实现预期收益的风险。

（三）募投项目新增 IC 封装基板等产品的风险

本次募投项目拟新增 IC 封装基板产品，并扩充高阶 HDI 产品产能。公司 IC 封装基板处于研发阶段，目前暂未量产，该产品在所需基材类型、生产工艺等方面，与公司现有产品存在一定差异。公司高阶 HDI 产品已具备量产能力，但目前在公司全部 HDI 产品中占比仍较少。若公司 IC 封装基板的研发量产不成功，高阶 HDI 的销售推广不达预期，可能影响募投项目的顺利实施或效益实现。

（四）即期回报被摊薄的风险

本次发行募集资金到位后，公司净资产规模和股本数量将有所提高，若募资金使用效益短期内难以全部显现，或短期内公司利润增长幅度将小于净资产和股本数量的增长幅度，公司的每股收益存在短期内被摊薄的风险。

四、其他风险

（一）新冠肺炎疫情风险

2020 年初，新冠肺炎疫情爆发，全球各行各业均遭受了不同程度的影响，疫情较为严重的国家及地方相继出台并执行了较为严格的防疫防控措施，如延迟复工、交通管制等，如果新冠肺炎疫情在全球范围内持续时间较长，则将对全球电子行业产业链造成较大冲击，并将直接影响 PCB 产业链，将给公司的生产经营带来不利影响。

（二）贸易摩擦风险

报告期各期，公司境外收入分别为 154,255.99 万元、208,411.94 万元、324,082.85 万元和 84,561.97 万元，境外收入占比分别为 49.13%、57.01%、60.85% 和 57.09%，占比较高。

近年来，国际贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护手段，降低或限制我国产品的进出口。2018 年以来，美国对进口产自中国的包括 PCB 产品在内的多项电子产品加征关税，同时我国政府采取反制措施，对产自美国的部分进口商品加征关税，公司对美国客户的销售受到一定影响。报告期内，公司出口美国产品收入占主营业务收入的比例分别为 0.03%、0.10%、0.02 和 0.00%，占比相对较小，因此贸易摩擦对公司境外销售及募投项目实施的影响较小。

若国际贸易摩擦加剧，可能会对全球经济及产业链竞争格局带来较大冲击，进而对中国整个 PCB 行业带来影响，对公司境外销售及经营业绩产生不利影响。

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

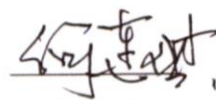
全体董事签名：



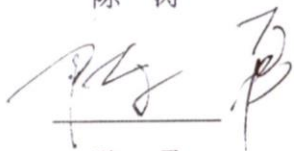
陈涛



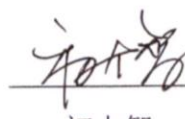
刘春兰



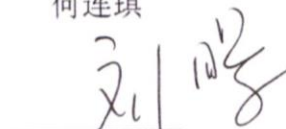
何连琪



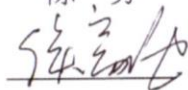
陈勇



初大智

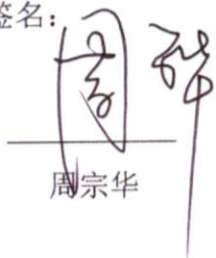


刘晖



侯富强

全体监事签名：



周宗华



魏军义

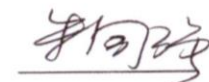


王耘

其他高级管理人员签名：



赵启祥



朱国强

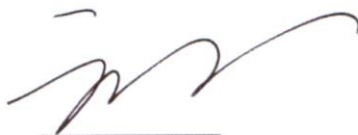
胜宏科技（惠州）股份有限公司

2024年8月24日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

_____		_____
陈 涛	刘春兰	何连琪
_____	_____	_____
陈 勇	初大智	刘 晖

侯富强		

全体监事签名：

_____	_____	_____
周宗华	魏军义	王耘

其他高级管理人员签名：

_____	_____
赵启祥	朱国强

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2021年8月24日

控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任

控股股东签名：深圳市胜华欣业投资有限公司（盖章）

控股股东法定代表人：



陈涛

实际控制人签名：



陈涛

2021年8月23日

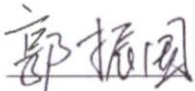
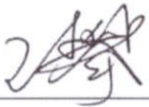
保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本人已认真阅读胜宏科技（惠州）股份有限公司募集说明书全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

曾开

保荐代表人：
 
郭振国 王攀

总经理：

邓舸

法定代表人：


张纳沙



发行人律师声明

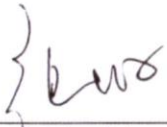
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在该募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签名：



张 炯

经办律师：



张 炯



宋幸幸



杨 斌




2021年8月24日

审计机构声明


本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：



邱靖之

签字注册会计师签名：



屈先富



陈志刚



王守军



邓玮

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



2024年 8月 24日

与本次发行相关的董事会声明及承诺事项

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

根据公司未来发展规划及行业发展趋势，同时结合公司的资本结构、融资需求以及资本市场发展情况，除本次发行外，公司董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他除本次向特定对象发行股票外的股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况安排股权融资，将按照相关法律法规履行审议程序和信息披露义务。

二、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报所采取的措施

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。

（一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

本次发行后，公司的总股本规模将增加，导致每股收益可能会在短期内出现小幅下降的情况，为了填补股东即期回报，公司决定采取如下措施：

1、不断完善公司治理，为公司可持续发展提供制度保障

公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，确保董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、合理的各项决策，确保独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司可持续发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

2、严格执行募集资金管理制度，保证募集资金合理规范使用

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理

制度》，规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效。根据《募集资金管理制度》和公司董事会决议，本次向特定对象发行股票结束后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，以保证募集资金合理规范使用。

3、在符合利润分配条件情况下，保证公司股东收益回报

公司按照相关法律法规的规定，在《公司章程》中进一步明确和完善了公司利润分配的原则和方式，完善公司利润分配的决策程序和机制，建立健全有效的股东回报机制。未来，公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，降低本次发行对公司即期回报的摊薄，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

综上，公司本次向特定对象发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，降低运营成本，并且在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

（二）公司董事会关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

公司董事会已按照国务院和中国证监会有关规定作出承诺并制定了兑现填补回报的具体措施，具体内容如下：

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对本人的职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；

5、未来公司如实施股权激励，股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；

本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述

承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

（本页无正文，为《胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会与本次发行相关的董事会声明及承诺事项》之盖章页）

胜宏科技（惠州）股份有限公司



2021年8月24日